

证券代码：688352

证券简称：颀中科技



合肥颀中科技股份有限公司

Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd.

（安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

摘要



保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二五年十月

声 明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关章节。

一、不满足投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保

公司本次发行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而存在兑付风险。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级

东方金诚对本次可转债进行了评级，根据东方金诚出具的《合肥顾中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字[2025]0240号），公司主体信用等级为“AA+”，本次可转债信用等级为“AA+”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转债存续期间，评级机构将对公司主体和本次可转债进行跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素导致公司或本次可转债的信用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、特别风险提示

公司提请投资者在做出投资决定前务必仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险

（一）技术及产品升级迭代的风险

随着全球集成电路行业的不断发展及终端应用产品对集成电路相关性能的要求不断提高，集成电路对端口密度、信号延迟及封装体积等提出了越来越高的要求。以显示驱动芯片为例，一方面，显示屏幕分辨率、清晰度的提升意味着更多 I/O 数量，对凸块制造的密度、间距提出越来越高的要求，测试的复杂性也随之提升，后段封装的精准度和难度也大幅增加；另一方面，AMOLED、MiniLed、MicroLed 等新型显示技术正处于发展阶段，相关新型显示技术对已有显示技术的升级迭代将间接对显示驱动芯片封测技术产生一定影响。

如果公司无法根据行业发展趋势和下游客户需求进行技术与产品创新，或新开发的产品质量未能得到客户认可，或研发项目无法顺利实现商业化，将可能面临订单流失、市场地位下降的风险，从而对公司的核心竞争力造成不利影响。

（二）非显示类业务开拓不利的风险

公司从 2015 年开始布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等非显示先进封装技术的研发，并于 2019 年完成后段 DPS 封装的建置，目前正在建置载板覆晶封装、BGBM/FSM、Cu Clip 制程。报告期内，公司非显示类业务虽增长较快但整

体规模相对较小，非全制程占比较高，且主要集中在电源管理、射频前端等芯片领域，客户主要集中在中国境内，与长电科技、通富微电、华天科技等头部综合类封测企业相比综合实力具有较大差距。若综合类封测企业对相关细分领域进行大规模投入、非显示类客户导入不及预期或下游终端市场环境出现不利变化等情况，则存在非显示封测业务开拓不利的风险。

（三）市场竞争加剧的风险

近年来，各大封测厂商积极布局先进封装业务，在显示驱动芯片封测领域，除细分行业龙头颀邦科技、南茂科技继续在相关领域保持领先地位外，综合类封测企业通过自建或与其他方合作等方式对相关领域也进行积极布局。相较于行业内头部封测企业，公司在资产规模、资本实力、产品服务范围等方面存在一定差距，面对行业竞争加剧的局面，若公司不能较好地采取措施应对，可能会对公司业务开拓以及经营业绩产生不利影响。

（四）募集资金投资项目相关风险

1、募投项目建设进度不及预期的风险

公司本次募集资金投资的建设项目包括高脚数微尺寸凸块封装及测试项目、先进功率及倒装芯片封测技术改造项目，是在发行人现有业务的基础上依据业务发展规划所制定的。虽然公司根据行业发展现状和趋势对本次募投项目可行性进行了深入研究和充分论证，并在技术、人员、市场等方面作了较为充分的准备，但若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司募投项目存在不能全部按期建设完成的风险。

2、募投项目产品验证进度不及预期的风险

公司本次募投项目中，高脚数微尺寸凸块封装及测试项目将新增铜镍金 Bumping 工艺在显示驱动芯片封装中的应用、先进功率及倒装芯片封测技术改造项目将新增载板覆晶封装、BGBM/FSM、Cu Clip 制程。若未来相关项目建设完成后相关产品验证进度不及预期或下游客户的采购需求不及预期，可能存在募投项目短期内无法盈利的风险，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

3、募投项目新增产能消化的风险

公司前次募投项目主要为显示驱动芯片封测业务产能建设，于 2024 年 12 月结项，目前尚处于产能爬坡阶段。公司本次募集资金投资项目的实施将会进一步增加显示驱动芯片封测业务铜镍金 Bumping、CP、COG 与 COF 等工序的产能。若公司不能相应有效地拓展产品市场，在客户开发、技术发展、经营管理等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，则可能导致公司未来存在一定的产能消化风险。

4、募投项目新增折旧或摊销影响公司利润的风险

公司本次募集资金投资项目中包含规模较大的资本性支出。项目建成并投产后，公司固定资产及无形资产规模将有所增长。本次募投项目的实施会导致公司未来整体折旧和摊销金额增加，虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充分的市场调查及可行性论证，预计项目实现的利润规模以及公司未来盈利能力的增长能够消化本次募投项目新增折旧和摊销。但鉴于未来行业发展趋势、下游客户需求以及市场竞争情况等存在不确定性，在本次募投项目对公司经营整体促进作用体现之前，公司存在因折旧或摊销增加而导致利润下降的风险。

5、募投项目效益不达预期的风险

公司对本次募投项目高脚数微尺寸凸块封装及测试项目、先进功率及倒装芯片封测技术改造项目进行了效益测算，待项目建设完成并达产后，预计可获得较好的经济效益。本次募投项目效益测算是基于项目如期建设完毕并按计划投产后实现销售，因此若项目建设进度不及预期、产品价格或成本出现大幅波动或者未来行业技术发展趋势出现重大变化，可能对本次募投项目的效益释放带来一定影响，募投项目可能面临短期内不能实现预测收入和利润的风险。同时，由于下游客户实际采购需求和本次募投项目的测算可能存在差距，如果本次募投项目的销售进展无法达到预期，可能导致本次募投项目面临营业收入和利润总额等经营业绩指标下滑，投资回报率降低的风险。

五、关于应对本次发行摊薄即期回报的应对措施及相关主体的承诺

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的

风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

1、持续完善公司治理、提升公司经营管理水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会（现由审计委员会行使）能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

2、稳健推进募投项目建设，提升持续盈利能力

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，其顺利实施将增强公司的盈利能力及核心竞争实力，优化公司的资本结构，提升公司的影响力。

本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将提高资金使用效率，稳健推进募投项目的实施，争取募投项目早日实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险，维护全体股东的长远利益。

3、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定及公司募集资金管理办法的要求，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。

公司董事会将持续对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

4、进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制

公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订了《合肥顾中科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（二）相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，为维护广大投资者的利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

1、控股股东承诺

公司控股股东合肥顾中控股为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，出具承诺如下：

“一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

二、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

三、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

2、董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

四、本人承诺由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

五、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

六、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

七、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

目 录

第一节 释义	11
一、一般释义	11
二、专业术语释义	13
第二节 本次发行概况	15
一、发行人基本情况	15
二、本次发行的基本情况	15
三、本次发行的有关机构	30
四、发行人与本次发行有关中介机构及其相关人员之间的关系	32
五、债券持有人会议规则	33
六、受托管理事项	45
第三节 发行人基本情况	59
一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况	59
二、公司控股股东、实际控制人基本情况	59
第四节 财务会计信息与管理层分析	69
一、最近三年及一期审计意见类型及重要性水平	69
二、最近三年及一期财务报表	69
三、发行人财务报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况	74
四、主要财务指标及非经常性损益明细表	75
五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正	78
六、主要税种和税率	79
七、财务状况分析	80
八、盈利能力分析	105
九、现金流量分析	120
十、资本性支出分析	123
十一、技术创新分析	123
十二、重大担保、诉讼或仲裁、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响	125
十三、本次发行对发行人的影响情况	126

第五节 本次募集资金运用	127
一、本次发行募集资金使用计划	127
二、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	128
三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司 科技创新水平提升的方式	140
四、本次募集资金对发行人经营和财务状况的影响	140
第六节 备查文件	142

第一节 释义

在募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般释义

《可转换公司债券募集说明书》、募集说明书	指	《合肥顾中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
本次发行	指	合肥顾中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
顾中科技、公司、发行人	指	合肥顾中科技股份有限公司
苏州顾中	指	顾中科技（苏州）有限公司，顾中科技全资子公司
顾中国际贸易	指	顾中国际贸易有限公司，苏州顾中全资子公司
合肥顾中控股	指	合肥顾中科技控股有限公司，曾用名为“合肥奕斯伟封测控股有限公司”，系发行人控股股东
芯屏基金	指	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
合肥市国资委	指	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人
联咏科技	指	联咏科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3034.TW
敦泰电子	指	敦泰电子股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3545.TW
奇景光电	指	奇景光电股份有限公司，美国纳斯达克上市公司，股票代码：HIMX.O
瑞鼎科技	指	瑞鼎科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3592.TW
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司
奕斯伟计算	指	北京奕斯伟计算技术股份有限公司
格科微	指	格科微有限公司，A股上市公司，股票代码为：688728.SH
谱瑞科技	指	谱瑞科技股份有限公司，中国台湾上柜公司，股票代码：4966.TWO
豪威科技	指	OmniVision Group，豪威集团（603501.SH）子公司
云英谷	指	云英谷科技股份有限公司
矽力杰	指	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：6415.TW
杰华特	指	杰华特微电子股份有限公司
南芯半导体	指	上海南芯半导体科技股份有限公司
艾为电子	指	上海艾为电子技术股份有限公司，A股上市公司，股票代码：688798.SH

唯捷创芯	指	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688153.SH
希荻微	指	希荻微电子集团股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688173.SH
颀邦科技、颀邦	指	颀邦科技股份有限公司，中国台湾上柜公司，股票代码：6147.TWO
南茂科技、南茂	指	南茂科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：8150.TW
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：600584.SH
通富微电	指	通富微电子股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：002156.SZ
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：002185.SZ
晶方科技	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：603005.SH
汇成股份	指	合肥新汇成微电子股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688403.SH
甬矽电子	指	甬矽电子（宁波）股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688362.SH
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688249.SH
先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	指	颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目
赛迪顾问、赛迪	指	赛迪顾问股份有限公司，直属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院
中国半导体行业协会	指	由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织
保荐机构、保荐人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师、竞天公诚律师	指	北京市竞天公诚律师事务所
会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月
报告期各期末	指	2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业术语释义

集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种将电路所需元器件及布线互连，集成在基片上并封装成具有所需电路功能的微型结构
吋	指	英寸的缩写，一寸等于 25.4 毫米
mm	指	毫米，长度单位，即千分之一米（ 10^{-3} 米）
nm	指	纳米，长度单位，即十亿分之一米（ 10^{-9} 米）
显示业务	指	显示驱动芯片封装业务
非显示业务	指	非显示类芯片封装业务
晶圆	指	Wafer，即制作硅半导体电路所用的硅晶片，由高纯度的硅晶棒研磨、抛光、切片后形成
晶粒、裸芯片	指	Die，将晶圆切割成芯片大小的方块，但尚未进行封装
射频	指	指可辐射到空间的电磁波频率，频率范围在 300KHz-300GHz 之间，包括蓝牙、WiFi、2.4G 无线传输技术、FM 等技术
FC、Flip Chip、倒装、覆晶封装	指	一种先进封装技术，FC 系 Flip Chip 的缩写，即倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸块，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸块和 PCB、引线框等衬底相连接
凸块制造技术	指	Bumping，在芯片上制作凸块，通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，广泛应用于 FC、WLP、CSP、3D 等先进封装
金凸块	指	Gold Bumping，是一种利用金凸块接合替代引线键合实现芯片与基板之间电气互联的制造技术，主要用于显示驱动芯片封装
铜柱凸块	指	Cu Pillar，是一种利用铜柱（Cu Pillar）接合替代引线键合实现芯片与基板之间电气互联的制造技术
铜镍金凸块	指	CuNiAu Bumping，是一种可优化 I/O 设计、大幅降低了导通电阻的凸块制造技术，凸块主要由铜、镍、金三种金属组成，可在较低成本下解决传统引线键合工艺的缺点
锡凸块	指	Sn Bumping，是一种利用锡（Sn）接合替代引线键合实现芯片与基板之间电气互联的制造技术
COG	指	Chip on Glass 的缩写，即玻璃覆晶封装，是一种将芯片直接结合在玻璃上的封装技术
COP	指	Chip on Plastic 的缩写，即柔性屏幕覆晶封装，是一种将芯片直接结合在柔性屏幕上的封装技术
COF	指	Chip on Film/Flex 的缩写，即薄膜覆晶封装，是一种将芯片结合在软性基板电路上的封装技术
DPS	指	Die Process Service 的缩写，指将晶圆研磨切割成单个芯片后准确放置在特制编带中的过程
CP	指	Chip Probing 的缩写，即晶圆测试，是一道用探针对每个晶粒上的接点进行接触测试其电气特性，标记出不合格的晶粒的工序
FT	指	Final Test 的缩写，即芯片成品测试，在晶圆被研磨切割成芯片后、出货前的测试环节，原理和 CP 基本类似
Cu Clip	指	铜片夹扣键合封装工艺
BGBM	指	Back-Side Grinding and Back-side Metallization 的缩写，即背面减薄及金属化
FSM	指	Front-Side Metallization 的缩写，即晶圆正面金属化

引脚	指	集成电路内部电路与外围电路的接线
I/O	指	Input/Output 的缩写，即输入输出端口
金盐	指	氰化亚金钾，是镀金工艺中一种十分重要的原材料，广泛被用于半导体、印制电路板等行业
靶材	指	溅镀工艺中，高速离子轰击的目标材料，其表面原子被轰击飞散并于基底表面沉积成膜
光刻胶、光阻液	指	可以通过光化学反应，经曝光、显影等光刻工序将所需微图形由掩模板转移至待加工基底上的一种光致抗蚀剂
散热贴	指	一种贴附在 COF 产品上的材质，可降低芯片工作时的温度
卷带、卷带式薄膜	指	柔性封装基板，即还未装联上芯片、元器件柔性基板
Tray 盘	指	晶粒盘，是用于承托晶粒（芯片）的托盘
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示，是一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示技术
AMOLED	指	Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode 的缩写，即有源矩阵有机发光二极管，其中 OLED（有机发光二极管）是描述薄膜显示技术的具体类型，AM（有源矩阵体或称主动式矩阵体）是指背后的像素寻址技术
4K	指	3840*2160 分辨率，属于超高清分辨率
8K	指	7680*4320 分辨率，为 4K 的 4 倍
PCB	指	印刷电路板（Printed Circuit Board），又称印刷线路板，PCB 是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体与电子元器件电气连接的载体
WLCSP	指	一种封装技术，Wafer Level Chip Scale Packaging 的缩写，晶圆片级芯片规模封装，此技术是先在整个晶圆上进行封装测试，其后再切割成单个芯片，可实现更大的带宽、更高的速度与可靠性以及更低的功耗
TSV	指	一种封装技术，Through Silicon Via 的缩写，即晶圆级系统封装-硅通孔，是一种通过硅通道垂直穿过组成堆栈的不同芯片或不同层实现不同功能芯片集成的封装技术
BGA	指	一种封装技术，Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装，圆形或柱状的焊点按阵列形式分布在基板下面的封装形式
MCM	指	一种封装技术，Multi-Chip Module 的缩写，即多芯组装，一种将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的封装形式
SiP	指	一种封装技术，System In a Package 的缩写，系统级封装，是将多种功能芯片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，实现一定功能的单个标准封装件，从而形成一个系统或者子系统
传统引线键合	指	Wire Bonding，即打线接合，集成电路封装产业中的制程之一，利用线径 15-50 微米的金属线材将芯片及导线架连接起来的技术

注：募集说明书在讨论、分析时，部分合计数与各数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入所致。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	合肥顾中科技股份有限公司
英文名称	Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd.
股本总额	1,189,037,288 元
股票简称	顾中科技
股票代码	688352
股票上市地	上海证券交易所
法定代表人	杨宗铭
有限公司成立日期	2018 年 1 月 18 日
股份公司成立日期	2021 年 12 月 9 日
上市日期	2023 年 4 月 20 日
注册地址	安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号
办公地址	安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号
邮政编码	230011
公司网址	http://www.chipmore.com.cn/
电子信箱	irsm@chipmore.com.cn
联系电话	0512-88185678
联系传真	0512-62531071

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行概况

1、本次发行的背景和目的

（1）本次发行有助于公司把握产业转移机遇，抓住市场增长机会

显示产业正加速向中国大陆转移，带动了产业链本土化配套需求的快速增长。2024 年中国大陆 LCD 面板产能达 2.16 亿平方米，全球占比达到 72.7%；AMOLED 面板产能达 1,607 万平方米，全球占比达到 38.0%，且预计 2028 年将提升至 44.4%。随着中国面板产业的快速发展和产能的持续扩张，上游显示驱动芯片封测的本土化配套需求日益迫切。首先，中国大陆面板厂商在全球的市场份额持续提升，带

动了本土配套的需求。其次，国际贸易环境的变化推动了产业链的重构，促使更多国际客户寻求中国大陆的封测产能。第三，国家持续加大对集成电路产业的支持力度，为行业发展创造了有利环境。

在此背景下，中国大陆显示驱动芯片封测企业迎来了难得的发展机遇。2024年全球显示驱动芯片封测市场规模同比增长6.0%，其中中国大陆市场规模达76.5亿元，同比增长7.0%，增速高于全球水平。预计到2028年全球市场规模将达到32.4亿美元，中国大陆市场将保持4%以上的稳定增长。首先是智能手机、平板电脑等消费电子的持续升级。根据赛迪统计，智能手机在显示面板下游终端出货量中占比最大，超过50%。特别是AMOLED渗透率的持续提升，带动了对高性能显示驱动芯片的需求。其次是大尺寸显示市场的结构性变化，预计到2026年，65英寸及以上的面板占比将达38.65%，超高清户外大屏出货量也有明显增长。随着分辨率的提升，单台设备所需的显示驱动芯片数量显著增加，如4K电视需要10-12颗显示驱动芯片，8K电视更是高达20颗。第三是新兴应用领域的快速扩张。车载显示、智能穿戴、虚拟现实等新兴领域对显示技术提出了更高要求，不仅需要更高的分辨率和刷新率，还需要更灵活的显示形态，这些都为显示驱动芯片封测带来新的市场机会。

（2）本次发行有助于公司推进技术创新与成本优化，提升市场竞争力

显示驱动芯片封测行业正面临重要的技术发展机遇。金凸块作为主流封装材料，在电性能、可靠性和工艺成熟度方面具备显著优势，是高端显示驱动芯片封装的重要技术选择。但随着下游应用市场的不断扩大，特别是在消费电子领域，市场对更具性价比的封装解决方案需求日益增长。铜镍金（CuNiAu）凸块技术通过在铜基底上镀覆镍层和薄金层的结构设计，在满足此类市场需求的同时实现了成本的有效控制，为显示驱动芯片封装提供了新的技术选择。从技术布局来看，发展多元化的封装技术路线，能够更好地满足不同细分市场的需求。金凸块技术将继续发挥其性能优势，而铜镍金凸块技术则可以满足对成本更为敏感的应用领域需求。这种差异化的技术布局有助于企业更好地服务不同类型的客户，扩大市场覆盖范围。

此外，公司将引入更为先进的自动化生产设备和智能化管理系统。在生产设备方面，将新增先进的高精度封装设备，提升生产的自动化水平，减少人工干预

带来的不确定性。在生产管理方面，将通过智能化系统实现生产过程的实时监控和精细化管理，优化生产排程，提高设备利用率。自动化和智能化水平的提升将帮助公司在保证产品质量的同时，显著提升生产效率，缩短产品交付周期，并通过减少人工成本、提高材料利用率、降低能源消耗等方式，优化公司的成本结构，持续提升公司的市场竞争力。

（3）本次发行有助于公司完善非显示类芯片封测制程，扩充业务版图

当前，集成电路行业正处于蓬勃发展且变革深刻的关键时期。在全球范围内，受益于物联网、人工智能、5G 等新兴科技的迅猛发展，集成电路市场规模持续扩张。在此背景下，非显示业务是公司未来优化产品结构、实现营收增长与推动战略发展的关键着力点。公司凭借在显示驱动芯片封测领域积累的深厚技术优势，积极将业务拓展至其他先进封装领域。始终秉持专注细分领域的核心战略，公司大力发展以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测业务。

依托于在显示驱动芯片封测业务多年来的积累，公司于 2015 年进入非显示类芯片封测领域，与行业内的头部企业相比，公司非显示类芯片封测业务的总体规模仍然较小。在制程方面，目前公司非显示类芯片封测业务主要集中于非全制程，业务收入主要来源于凸块制造和晶圆测试环节，全制程收入占比较低。

通过本次发行，公司将新导入载板覆晶封装、BGBM/FSM、Cu Clip 制程，构建起完善的全制程封测技术体系，极大地提升了公司在非显示类芯片封测领域的市场竞争实力，为后续业务的进一步拓展与市场份额的提升奠定了坚实基础。

2、本次发行的核准情况

公司本次发行已经 2025 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第三次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

本次发行已于 2025 年 9 月 11 日通过上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 35 次审议会议审议，并于 2025 年 10 月 15 日取得中国证监会下发的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2289 号）。

（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

2、发行数量

本次可转换公司债券的发行数量为 850,000 手（8,500,000 张）。

3、发行规模

本次发行可转换公司债券总额为人民币 85,000.00 万元。

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

5、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 11 月 3 日至 2031 年 11 月 2 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

6、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

7、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

8、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年11月7日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月7日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2031年11月2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

9、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.75元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量

(2) 转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

10、转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

(2) 修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的公司股份须为整股数。转股时不足转换

1 股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应当期应计利息。

12、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外，当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转换公司债券。

13、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“12、赎回条款”的相关内容。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“12、赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可

转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

15、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。

本次可转换公司债券的发行对象如下:

(1) 向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即 2025 年 10 月 31 日, T-1 日)收市后登记在册的发行人所有股东。

(2) 网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转换公司债券申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理有关事项的通知(2025 年 3 月修订)》(上证发〔2025〕42 号)的相关要求。

(3) 本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

16、向原股东优先配售的安排

(1) 发行对象

在股权登记日(2025 年 10 月 31 日, T-1 日)收市后登记在册的发行人所有股东。

(2) 优先配售数量

原股东可优先配售的顾中转债数量为其在股权登记日(2025 年 10 月 31 日, T-1 日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 0.720 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.000720 手可转换公司债券。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转换公司债券股权登记日(T-1 日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化,发行人和保荐人(主承销商)将于申购日(T 日)前(含)披露原股东优先配售比例调整公告。

原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转换公司债券的可配售数量。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本1,189,037,288股，剔除公司回购专户库存股8,714,483股后，可参与原股东优先配售的股本总额为1,180,322,805股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转换公司债券上限总额为850,000手。

（3）原股东的优先认购方法

1）优先配售日期

①股权登记日：2025年10月31日（T-1日）；

②原股东优先配售认购及缴款日：2025年11月3日（T日）在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00进行，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行；

③原股东优先配售缴款时间：2025年11月3日（T日）。

2）原股东的优先认购方式

所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2025年11月3日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726352”，配售简称为“顾中配债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超出1手必须是1手的整数倍。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配顾中转债，请投资者仔细查看证券账户内“顾中配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

原股东持有的“顾中科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

3）原股东的优先认购程序

①投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“顾中配债”的可配余额。

②原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

③投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

④投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

⑤投资者的委托一经接受，不得撤单。

4) 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配顾中转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

(4) 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

17、债券持有人会议相关事项

债券持有人会议相关事项参见本节“五、债券持有人会议规则”。

18、本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	41,945.30	41,900.00
2	顾中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	43,166.12	43,100.00
合计		85,111.42	85,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的

重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

19、募集资金管理及存放账户

公司已建立《募集资金管理办法》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

20、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

21、评级事项

东方金诚对本次发行的可转换公司债券进行了评级，根据东方金诚出具的信用评级报告，主体信用等级为“AA+”，本次可转换公司债券信用等级为“AA+”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

22、本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

（三）违约责任及争议解决机制

1、以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事件

（1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

（2）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

(3) 公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生实质不利影响,或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响;

(4) 在本期可转债存续期间内,公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序;

(5) 任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决,或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令,或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法;

(6) 在本期可转债存续期间,公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

上述违约事件发生时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等,并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

本期可转债发行适用于中国法律并依其解释。本期可转债发行和存续期间所产生的争议,首先应在争议各方之间协商解决;协商不成的,应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利,并应履行其他义务。

(四) 受托管理

受托管理事项参见本节“六、受托管理事项”。

(五) 承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司以余额包销方式承销。

本次可转换公司债券的承销期为 2025 年 10 月 30 日至 2025 年 11 月 7 日。

（六）发行费用

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	800.00
审计及验资费用	179.25
律师费用	75.47
资信评级费用	23.58
信息披露、手续费、路演推介等费用	42.69
合计	1,120.99

注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

（七）主要日程与停复牌示意性安排

本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

日期	发行安排
T-2 日 (2025 年 10 月 30 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
T-1 日 (2025 年 10 月 31 日)	网上路演：原股东优先配售股权登记日
T 日 (2025 年 11 月 3 日)	刊登发行提示性公告：原股东优先认购日；网上、网下申购日
T+1 日 (2025 年 11 月 4 日)	刊登网上中签率及网下发行配售结果公告：进行网上申购的摇号抽签
T+2 日 (2025 年 11 月 5 日)	刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款； 网上投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资
T+3 日 (2025 年 11 月 6 日)	根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果
T+4 日 (2025 年 11 月 7 日)	刊登发行结果公告

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

（八）本次发行证券的上市流通

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市，具

体上市时间将另行公告。

（九）本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥硕中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用 187,373,816.76 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,232,626,183.24 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金已使用 94.75%（含超募资金），募集资金投向未发生变更且按计划投入。

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”、“硕中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目”。本次发行募集资金的运用符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于提升公司综合实力，对公司战略的实现具有积极意义。项目完成后，将显著增强公司在先进封装测试领域的综合竞争实力，提高公司持续盈利能力，巩固提升行业地位。本次发行募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

综上，公司本次发行聚焦主业，理性融资，融资规模合理。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称：	合肥硕中科技股份有限公司
法定代表人：	杨宗铭
注册地址：	安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号
办公地址：	安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号
联系电话：	0512-88185678
传真：	0512-62531071
董事会秘书：	余成强

（二）保荐机构（主承销商）

名称：	中信建投证券股份有限公司
法定代表人：	刘成
注册地址：	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：	北京市朝阳区景辉街 16 号泰康大厦 10 层
联系电话：	021-68801585
传真：	021-68801551
保荐代表人：	吴建航、廖小龙
项目协办人：	朱曦
项目组其他成员：	傅志武、谭谷、张芮钦、邓智威

（三）律师事务所

名称：	北京市竞天公诚律师事务所
负责人：	赵洋
注册地址：	北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
办公地址：	北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
联系电话：	010-58091000
传真：	010-58091100
经办律师：	范瑞林、张圣琦、路璐

（四）会计师事务所

名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	邱靖之
注册地址：	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
办公地址：	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
联系电话：	021-51028018
传真：	021-58402702
经办注册会计师：	王兴华、马罡、李玮俊（已离职）、刘莹（已离职）、刘华凯、朱逸莲、杨笑

（五）资信评级机构

名称：	东方金诚国际信用评估有限公司
法定代表人：	崔磊
注册地址：	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

办公地址:	北京市丰台区丽泽金融商务区平安幸福中心 A 座 45、46、47 层
联系电话:	010-62299800
传真:	010-62299803
经办评级人员:	王璐璐、吴马兰

(六) 申请上市的证券交易所

名称:	上海证券交易所
办公地址:	上海市浦东新区杨高南路 388 号
联系电话:	021-68808888
传真:	021-68804868

(七) 证券登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:	上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话:	021-58708888
传真:	021-58899400

(八) 本次可转债的收款银行

收款银行:	北京农商银行商务中心区支行
户名:	中信建投证券股份有限公司
银行账号:	0114020104040000065

四、发行人与本次发行有关中介机构及其相关人员之间的关系

截至 2025 年 6 月 30 日,中信建投投资有限责任公司科创板跟投持有发行人 6,000,000 股股份,持股比例 0.5046%;中信建投基金-顾中科技员工参与战略配售集合资产管理计划持有发行人 22,301,841 股股份,持股比例 0.1936%;中信建投证券资产管理部持有发行人 5,704 股股份,持股比例 0.0005%;中信建投证券衍生品部持有发行人 12,741 股股份,持股比例 0.0011%。上述持股主体合计持有发行人 8,320,286 股股份,持股比例 0.6997%。

除此之外,截至募集说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

五、债券持有人会议规则

《债券持有人会议规则》主要条款如下：

（一）债券持有人的权利和义务

1、可转换公司债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
- （3）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
- （5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
- （6）按照《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（二）债券持有人会议的权限范围

债券持有人会议的权限范围如下：

1、当公司提出变更《可转换公司债券募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转换公司债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转换公司债券募集说明书》中的赎回或回售条款等；

2、当公司未能按期支付本次可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

3、当公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

4、当保证人（如有）、担保物（如有）或其他有偿保障措施发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

5、当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

6、在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

7、对变更、解聘债券受托管理人或变更债券受托管理协议主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任）作出决议；

8、法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

可转换公司债券存续期间，债券持有人会议按照本条约定的权限范围，审议并决定与债券持有人利益有重大关系的事项。

（三）债券持有人会议的召集

1、债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。公司董事会

或债券受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。

公司董事会或债券受托管理人应在会议召开 15 日前公告会议通知，向全体债券持有人及有关出席对象发出会议通知。召集人认为需要紧急召集债券持有人会议以有利于债券持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。

2、在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（4）公司已经或者预计不能按期支付本次可转换公司债券本息；

（5）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

（7）保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；

（8）公司、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

（9）公司提出债务重组方案的；

（10）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（12）《可转换公司债券募集说明书》约定的其他应当召开债券持有人会议

的情形；

(13) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司董事会、单独或者合计持有本次发行的可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开持有人会议的，债券受托管理人应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。

3、下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 债券受托管理人；

(3) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有人；

(4) 法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

4、本规则“（三）债券持有人会议的召集”第 2 条规定的事项发生之日起 15 日内，如公司董事会或债券受托管理人未能按本规则规定履行其职责，单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

5、债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。

6、债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会

议通知。债券持有人会议的通知应包括但不限于以下内容：

- (1) 会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
- (2) 提交会议审议的事项；
- (3) 以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议并行使表决权；
- (4) 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
- (5) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书；
- (6) 召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
- (7) 召集人需要通知的其他事项。

7、债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前 10 个交易日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 个交易日。于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的可转换公司债券持有人，为有权出席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。

8、召开债券持有人现场会议的地点原则上应为公司住所地。会议场所由公司提供或由债券持有人会议召集人提供。公司亦可采取网络、通讯或者证券监管机构认可的其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席。

9、符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为当次会议召集人。

10、召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：

- (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定；
- (2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (4) 应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。

11、召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

合计持有本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人提议召集债券持有人会议时，可以共同推举 1 名代表作为联络人，协助受托管理人完成会议召集相关工作。

（四）债券持有人会议的议案、出席人员及其权利

1、提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。

2、召集人披露债券持有人会议通知后，受托管理人、公司、单独或者合计持有本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人均可以书面形式提出议案，召集人应当将相关议案提交债券持有人会议审议。

召集人应当在会议通知中明确提案人提出议案的方式及时限要求。

3、债券持有人会议审议事项由召集人根据本规则“（二）债券持有人会议的权限范围”和“（三）债券持有人会议的召集”第 2 条的规定决定。

单独或合并代表持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5 日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

4、债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代

为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

5、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

债券持有人会议以非现场方式召开的，召集人应当在会议通知中明确债券持有人或其代理人参会资格确认方式、投票方式、计票方式等事项。

6、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应当载明下列内容：

- （1）代理人的姓名、身份证号码；
- （2）代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；
- （3）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （4）授权代理委托书签发日期和有效期限；
- （5）委托人签字或盖章。

授权委托书应当注明，如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前送交债券持有人会议召集人。

7、召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本次可转换公司债券的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证，并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本次可转换公司债券的张数。

上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构取得，并无偿提供给召集

人。

8、债券持有人会议拟授权受托管理人或推选代表人代表债券持有人与公司或其控股股东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有人提起或参加仲裁、诉讼程序的，提案人应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有人选择：

（1）特别授权受托管理人或推选的代表人全权代表债券持有人处理相关事务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划草案和和解协议进行表决等实质影响甚至可能减损、让渡债券持有人利益的行为。

（2）授权受托管理人或推选的代表人代表债券持有人处理相关事务的具体授权范围，并明确在达成协商协议或调解协议、在破产程序中就发行人重整计划草案和和解协议进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有人利益的行为时，应当事先征求债券持有人的意见或召集债券持有人会议审议并依债券持有人意见行事。

（五）债券持有人会议的召开

1、债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。

2、债券持有人会议应由公司董事会或债券受托管理人委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会或债券受托管理人未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后一小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人担任会议主席并主持会议。

债券持有人会议由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。

3、应单独或合并持有本次债券表决权总数 10%以上的债券持有人的要求，

公司应委派至少一名董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

4、会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称或姓名、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。

会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本次可转换公司债券张数总额之前，会议登记应当终止。

5、下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事和高级管理人员、债券托管人、债券担保人（如有）以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转换公司债券而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

6、会议主席有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决议要求，会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议不得对原先会议议案范围外的事项做出决议。

（六）债券持有人会议的表决、决议及会议记录

1、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

3、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、附带条件的表决、对于同一议案存在多个表决意见的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决票出现重复的以第一次投票结果为准。

4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次可转债张数：

（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；

（2）上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

经会议主席同意，本次债券的担保人（如有）或其他重要相关方可以参加债券持有人会议并有权就相关事项进行说明，但无表决权。

5、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。

每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一公司名称授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

6、会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

7、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。

8、除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持

有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

9、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转换公司债券募集说明书》和本规则的规定，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，依据本规则经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

任何与本次可转换公司债券有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和《可转换公司债券募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外：

（1）如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；

（2）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

10、债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、方式、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转换公司债券张数及占本次可转换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容。

11、债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：

（1）召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；

（2）会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、计票人、监票人和清点人的姓名；

（3）出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转换公司债券张数及出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转换公司债券张数占公司本次可转换公司债券总张数的比例；

（4）对每一拟审议事项的发言要点；

(5) 每一表决事项的表决结果；

(6) 债券持有人的质询意见、建议及公司董事或高级管理人员的答复或说明等内容；

(7) 法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。

12、会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）、见证律师、记录员和监票人签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年。

13、召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

14、公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。

债券持有人应当积极配合受托管理人、公司或其他相关方推动落实债券持有人会议生效决议有关事项。

15、债券持有人授权受托管理人提起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼或者申请、参加破产程序的，受托管理人应当按照授权范围及实施安排等要求，勤勉履行相应义务。受托管理人因提起、参加仲裁、诉讼或破产程序产生的合理费用，由作出授权的债券持有人承担，或者由受托管理人依据与债券持有人的约定先行垫付，债券受托管理协议另有约定的，从其约定。

受托管理人依据授权仅代表部分债券持有人提起、参加债券违约合同纠纷仲裁、诉讼或者申请、参加破产程序的，其他债券持有人后续明确表示委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的，受托管理人应当一并代表其提起、参加仲裁或诉

讼。受托管理人也可以向未授权的债券持有人征集由其代表其提起、参加仲裁或诉讼。受托管理人不得因授权时间与方式不同而区别对待债券持有人，但非因受托管理人主观原因导致债券持有人权利客观上有所差异的除外。

未委托受托管理人提起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有人可以自行提起、参加仲裁或诉讼，或者委托、推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。

受托管理人未能按照授权文件约定勤勉代表债券持有人提起、参加仲裁或诉讼，或者在过程中存在其他怠于行使职责的行为，债券持有人可以单独、共同或推选其他代表人提起、参加仲裁或诉讼。

六、受托管理事项

2025年6月，发行人（甲方）与中信建投证券（乙方）签订了《合肥硕中科技股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》，聘任中信建投证券作为本期可转债的受托管理人，并同意接受中信建投证券的监督。凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期可转债的投资者，均视同自愿接受中信建投证券担任本期可转债的受托管理人，同意本协议中关于甲方、乙方、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转债的受托管理人。

《受托管理协议》的主要条款如下：

（一）甲方的权利和义务

1、甲方享有以下权利：

（1）提议召开可转债持有人会议；

（2）向可转债持有人会议提出更换受托管理人的议案；

（3）对乙方没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，甲方有权予以制止；可转债持有人对甲方的上述制止行为应当认可；

（4）依据法律、法规和规则、募集说明书、可转债持有人会议规则的规定，甲方所享有的其他权利。

2、甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期可转债的利息和本金。在本期可转债任何一笔应付款项到期日前，甲方应向债券受托管理人做出下述确认：甲方已经向其开户行发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项的不可撤销的付款指示。

3、甲方应当指定专项账户，用于本期可转债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并应为本期可转债的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律、法规和规则的有关规定及募集说明书的有关约定。

4、本期可转债存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定制定信息披露事务管理制度，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法律、法规和规则的规定及时向中国证监会和/或证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（3）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；

（4）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

（5）未转换的可转债总额少于三千万元；

（6）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（7）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；

（8）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评

级，并已出具信用评级结果的；

（9）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；

（10）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。

甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。

6、甲方应按乙方要求在可转债持有人会议召开前，从债券托管机构取得债权登记日转让结束时持有本期可转债的可转债持有人名册，并在债权登记日之后一个交易日将该名册提供给乙方，并承担相应费用。除上述情形外，甲方应每年（或根据乙方合理要求的间隔更短的时间）向乙方提供（或促使登记公司提供）更新后的可转债持有人名册。

7、甲方应当履行可转债持有人会议规则及可转债持有人会议决议项下甲方应当履行的各项职责和义务。

一旦发现发生本节“（八）违约责任”第2条所述的违约事件，甲方应书面通知乙方，同时根据乙方要求详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施。

8、预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，同时配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的相关费用，应当按照本协议规定由甲方承担；因乙方申请财产保全措施而产生的相关费用应当按照本协议规定由可转债持有人承担。

9、甲方无法按时偿付本期可转债本息时，甲方应当按照募集说明书的约定落实全部或部分偿付及实现期限、增信机构或其他机构代为偿付安排、重组或者

破产安排等相关还本付息及后续偿债措施安排并及时报告可转债持有人、书面通知乙方。

10、甲方应对乙方履行本协议第四条项下各项职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据，全力支持、配合乙方进行尽职调查、审慎核查工作，维护投资者合法权益。甲方所提供的文件、资料和信息包括但不限于：

（1）所有为乙方了解甲方及/或保证人（如有）业务所需而应掌握的重要文件、资料和信息，包括甲方及/或保证人（如有）及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景等信息和资料；

（2）乙方或甲方认为与乙方履行受托管理职责相关的所有协议、文件和记录的副本；

（3）根据本节“（一）甲方的权利和义务”第6条约定甲方需向乙方提供的资料；

（4）其它与乙方履行受托管理职责相关的一切文件、资料和信息。

甲方须确保其提供的上述文件、资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保其向乙方提供上述文件、资料和信息不会违反任何保密义务，亦须确保乙方获得和使用上述文件、资料和信息不会违反任何保密义务。

甲方认可乙方有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。如甲方发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误导，或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得，或者提供该等文件、资料和信息或乙方使用该等文件、资料和信息系未经所需的授权或违反了任何法律、责任或在先义务，甲方应立即通知乙方。

11、甲方应指定专人负责与本期可转债相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通，配合乙方所需进行的现场检查。

本期可转债设定保证担保的，甲方应当敦促保证人配合乙方了解、调查保证人的资信状况，要求保证人按照乙方要求及时提供经审计的年度财务报告、中期

报告及征信报告等信息，协助并配合乙方对保证人进行现场检查。

12、受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。

13、在本期可转债存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。

14、甲方应当根据本协议的相关规定向乙方支付本期可转债受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的其他额外费用。

15、本期可转债存续期间，甲方应当聘请资信评级机构进行定期和不定期跟踪信用评级。跟踪评级报告应当同时向甲方和交易所提交，并由甲方和资信评级机构及时向市场披露。

16、甲方和资信评级机构应当于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年的债券信用跟踪评级报告。确有合理理由且经交易所认可的，可以延期披露。

17、在不违反法律、法规和规则的前提下，甲方应当在公布年度报告后 15 个交易日内向乙方提供一份年度审计报告及经审计的财务报表、财务报表附注的复印件，并根据乙方的合理需要向其提供其他相关材料；甲方应当在公布半年度报告后 15 个交易日内向乙方提供一份半年度财务报表的复印件。

18、受托管理期间，甲方应遵守并督促其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和其他规则关于受托管理的规定，完善治理、规范运作、不得侵害可转债持有人利益，切实维护持有人权益。

19、甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。

（二）乙方的职责、权利和义务

1、乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

2、乙方应当持续关注甲方和保证人（如有）的经营状况、财务状况、资信状况、担保物（如有）状况、内外部增信机制（如有）及偿债保障措施的有效性

及实施情况，以及可能影响可转债持有人重大权益的事项。

乙方有权采取包括但不限于如下方式进行核查：

- (1) 就本节“（一）甲方的权利和义务”第5条约定的情形，列席甲方和保证人（如有）的内部有权机构的决策会议；
- (2) 至少每半年一次查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；
- (3) 调取甲方、保证人（如有）银行征信记录；
- (4) 对甲方和保证人（如有）进行现场检查；
- (5) 约见甲方或者保证人（如有）进行谈话。

3、乙方应当对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期可转债存续期内，乙方应当至少每半年一次检查甲方募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

4、乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议、可转债持有人会议规则的主要内容。

5、乙方应当至少每半年一次，对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。

6、出现本节“（一）甲方的权利和义务”第6条规定情形或可能对可转债持有人权益有重大影响的，在知道或应当知道该等情形之日起五个交易日内，乙方应当问询甲方或者保证人（如有），要求甲方、保证人（如有）解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发可转债持有人会议情形的，召集可转债持有人会议。

7、乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及可转债持有人会议规则的规定召集可转债持有人会议，并监督相关各方严格执行可转债持有人会议决议，监督可转债持有人会议决议的实施。

8、乙方应当在债券存续期内持续督导甲方履行信息披露义务。乙方应当关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本期可转债偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期可转债本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告可转债持有人。

9、乙方应当建立对甲方偿债能力的跟踪机制，监督甲方对债券募集说明书所约定义务的执行情况，持续动态监测、排查、预警并及时报告债券信用风险，采取或者督促甲方等有关机构或人员采取有效措施防范、化解信用风险和处置违约事件，保护投资者合法权益。

10、乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，督促甲方履行本节“（一）甲方的权利和义务”第8条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。为免歧义，本条项下乙方实施追加担保或申请财产保全的，不以可转债持有人会议是否已召开或形成有效决议为先决条件。

因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的相关费用，应当按照本协议规定由甲方承担；因乙方申请财产保全措施而产生的相关费用应当按照本协议规定由可转债持有人承担。

11、本期可转债存续期内，乙方应当勤勉处理可转债持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。

12、甲方为本期可转债设定担保的，乙方应当在本期可转债发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。

13、甲方不能偿还债务时，乙方应当督促甲方、增信机构（如有）和其他具有偿付义务的相关主体落实相应的偿债措施，并可以接受全部（形成可转债持有人会议有效决议或全部委托，下同）或部分可转债持有人（未形成可转债持有人会议有效决议而部分委托，下同）的委托，以自己名义代表可转债持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。

为免歧义，本条所指乙方以自己名义代表可转债持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序，包括法律程序参与权以及在法律程序中基于合理维护可转债持有人最大利益的实体表决权。其中的破产（含重整）程序中，乙方有权代表全体可转债持有人代为进行债权申报、参加债权人会议、并接受全部或部分可转债持有人的委托表决重整计划等。

14、乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司可转债持有人权益有重大

影响的事项为自己或他人谋取利益。

15、乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于本协议、可转债持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于本期可转债到期之日或本息全部清偿后五年。

16、除上述各项外，乙方还应当履行以下职责：

- （1） 可转债持有人会议授权乙方履行的其他职责；
- （2） 募集说明书约定由乙方履行的其他职责。

17、在本期可转债存续期内，乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估师等第三方专业机构提供专业服务。

18、对于乙方因依赖其合理认为是真实且经适当方签署的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采取的任何作为、不作为或遭受的任何损失，乙方应得到保护且不应对此承担责任；乙方依赖甲方根据本协议的规定而通过邮件、传真或其他数据电文系统传输发出的合理指示并据此采取的任何作为或不作为行为应受保护且不应对此承担责任。但乙方的上述依赖显失合理或不具有善意的除外。

19、除法律、法规和规则禁止外，乙方可以通过其选择的任何媒体宣布或宣传其根据本协议接受委托和/或提供的服务，以上的宣布或宣传可以包括甲方的名称以及甲方名称的图案或文字等内容。

（三）受托管理事务报告

1、受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

2、乙方应当建立对甲方的定期跟踪机制，监督甲方对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：

- (1) 乙方履行职责情况；
- (2) 甲方的经营与财务状况；
- (3) 甲方募集资金使用及专项账户运作情况；
- (4) 甲方偿债意愿和能力分析；
- (5) 内外部增信机制（如有）、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；
- (6) 甲方偿债保障措施的执行情况以及本期可转债的本息偿付情况；
- (7) 本期可转债转股情况以及转股价格调整情况（如有）；
- (8) 赎回条款、回售条款等约定条款的执行情况；
- (9) 甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况；
- (10) 可转债持有人会议召开的情况；
- (11) 发生本节“（一）甲方的权利和义务”第5条等情形的，说明基本情况及处理结果；
- (12) 对可转债持有人权益有重大影响的其他事项。

3、可转债存续期内，出现乙方与甲方发生利益冲突、甲方募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现本节“（一）甲方的权利和义务”第5条等情形且对可转债持有人权益有重大影响的，乙方在知道或应当知道该等情形之日起五个交易日内向市场公告临时受托管理事务报告。

（四）可转债持有人的权利与义务

1、可转债持有人享有下列权利：

- (1) 按照募集说明书约定到期兑付本期可转债本金和利息；
- (2) 根据可转债持有人会议规则的规定，出席或者委派代表出席可转债持有人会议并行使表决权；在可转债受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合并持有本期可转债总额百分之十以上的可转债持有人有权自行召集可转债持有人会议；

(3) 监督甲方涉及可转债持有人利益的有关行为，当发生利益可能受到损害的事项时，有权依据法律、法规和规则及募集说明书的规定，通过可转债持有人会议决议行使或者授权乙方代其行使可转债持有人的相关权利；

(4) 监督乙方的受托履责行为，并有权提议更换受托管理人；

(5) 在满足赎回条件、回售条件时，要求甲方执行赎回条款、回售条款；

(6) 在满足转股条件时，可以选择将持有的甲方可转换公司债券转换为甲方股票，并于转股的次日成为甲方股东；

(7) 法律、法规和规则规定以及本协议约定的其他权利。

2、可转债持有人应当履行下列义务：

(1) 遵守募集说明书的相关约定；

(2) 乙方依本协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由本期可转债持有人承担。乙方没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，未经可转债持有人会议决议追认的，不对全体可转债持有人发生效力，由乙方自行承担其后果及责任；

(3) 接受可转债持有人会议决议并受其约束；

(4) 不得从事任何有损甲方、乙方及其他可转债持有人合法权益的活动；

(5) 如乙方根据本协议约定对甲方启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他法律程序的，可转债持有人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及乙方因按可转债持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求乙方为其先行垫付；

(6) 根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，应当由可转债持有人承担的其他义务。

(五) 利益冲突的风险防范机制

1、乙方不得为本期可转债提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何交易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害可转债持有人的合法权益。

2、乙方在履行受托管理职责时，将通过以下措施管理可能存在的利益冲突

情形及进行相关风险防范：

（1）乙方作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与乙方在本协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于，甲乙双方之间，一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务；

（2）针对上述可能产生的利益冲突，乙方将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与本协议项下乙方作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务；

（3）截至本协议签署，乙方除同时担任本期可转债的保荐人、主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形；

（4）当乙方按照法律、法规和规则的规定以及本协议的约定诚实、勤勉、独立地履行本协议项下的职责，甲方以及本期可转债的持有人认可乙方在为履行本协议服务之目的而行事，并确认乙方（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免乙方因此等利益冲突而可能产生的责任。

3、因甲乙双方违反利益冲突防范机制对可转债持有人造成直接经济损失的，由甲乙双方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。

（六）受托管理人的变更

1、在本期可转债存续期内，出现下列情形之一的，应当召开可转债持有人会议，履行变更受托管理人的程序：

- （1）乙方未能持续履行本协议约定的受托管理人职责；
- （2）乙方停业、解散、破产或依法被撤销；
- （3）乙方提出书面辞职；

(4) 乙方不再符合受托管理人资格的其他情形。

在受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合计持有本期可转债总额百分之十以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议。

2、可转债持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘乙方的，自本节“(六) 受托管理人的变更”第4条约定的新任受托管理人与甲方签订受托管理协议之日或双方约定之日，新任受托管理人继承乙方在法律、法规和规则及本协议项下的权利和义务，本协议终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向协会报告。

3、乙方应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。

4、乙方在本协议中的权利和义务，在新任受托管理人与甲方签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除乙方在本协议生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。

(七) 信用风险管理

为了加强本次债券存续期信用风险管理，保障本次可转债持有人合法权益，甲方、乙方应当按照本协议和募集说明书的约定切实履行信用风险管理职责，加强相互配合，共同做好债券信用风险管理工作。

(八) 违约责任

1、本协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及本协议的规定追究违约方的违约责任。

2、以下任一事件均构成甲方在本协议和本期可转债项下的违约事件：

(1) 在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

(2) 公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第1项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

(3) 公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还

本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

（4）在本期可转债存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

（5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

（6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

3、上述违约事件发生时，乙方行使以下职权：

（1）在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体可转债持有人；

（2）在知晓甲方发生本节“（八）违约责任”第2条第（1）项规定的未偿还本期可转债到期本息的，乙方应当召集可转债持有人会议，按照会议决议规定的方式追究甲方的违约责任，包括但不限于向甲方提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程序；在可转债持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下，乙方可以按照《管理办法》的规定接受全部或部分可转债持有人的委托，以自己名义代表可转债持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；

（3）在知晓甲方发生本节“（八）违约责任”第2条规定的情形之一的（本节“（八）违约责任”第2条第（1）项除外），并预计甲方将不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，并可依法申请法定机关采取财产保全措施；

（4）及时报告证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。

4、加速清偿及措施

（1）如果发生本节“（八）违约责任”第2条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续交易日仍未得到纠正，可转债持有人可按可转债持有人会议规则形成有效可转债持有人会议决议，以书面方式通知甲方，宣布所有未偿还的本期可转债本金和相应利息，立即到期应付；

(2) 在宣布加速清偿后，如果甲方采取了下述救济措施，乙方可根据可转债持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知甲方取消加速清偿的决定：

①乙方收到甲方或甲方安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期可转债利息和/或本金、甲方根据本协议应当承担的费用，以及乙方根据本协议有权收取的费用和补偿等；或

②本节“（八）违约责任”第2条所述违约事件已得到救济或被可转债持有人通过会议决议的形式豁免；或

③可转债持有人会议决议同意的其他措施；

(3) 本条项下可转债持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转债持有人（或可转债持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

5、上述违约事件发生时，甲方应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就乙方因甲方违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

6、双方同意，若因甲方违反本协议任何规定、承诺和保证（包括但不限于本期可转债发行、上市交易的申请文件或募集说明书以及本期可转债存续期间内披露的其他信息出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）或因甲方违反与本协议或与本期可转债发行、上市交易相关的任何法律规定或上市规则，从而导致乙方或任何其他受补偿方遭受损失、责任和费用（包括但不限于他人对乙方或任何其他受补偿方提出权利请求或索赔），甲方应对乙方或其他受补偿方给予赔偿（包括但不限于偿付乙方或其他受补偿方就本赔偿进行调查、准备、抗辩所支出的所有费用），以使乙方或其他受补偿方免受损害，但因乙方在本期可转债存续期间重大过失而导致的损失、责任和费用，甲方无需承担。

第三节 发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,189,037,288 股，公司股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	股份比例（%）
一、有限售条件的流通股股份	823,156,165	69.23
二、无限售条件的流通股股份	365,881,123	30.77
三、股份总数	1,189,037,288	100.00

截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	合肥顾中科技控股有限公司	397,127,159	33.40	397,127,159
2	Chipmore Holding Company Limited	302,389,708	25.43	302,389,708
3	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	123,639,298	10.40	123,639,298
4	CTC Investment Company Limited	34,397,878	2.89	-
5	中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	11,262,534	0.95	-
6	张鸿飞	11,037,000	0.93	-
7	国华人寿保险股份有限公司－自有四号	7,013,580	0.59	-
8	中信建投投资有限公司	6,000,000	0.50	-
9	宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管理合伙企业（有限合伙）－中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	5,782,419	0.49	-
10	陈永正	5,749,000	0.48	-
合计		904,398,576	76.06	823,156,165

二、公司控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东和实际控制人情况

截至募集说明书签署日，合肥顾中控股持有公司 33.40%的股份，持股比例超过 30%，足以对公司的股东会决议产生重大影响，系公司的控股股东。此外，合肥市国资委下属合肥建投控制的芯屏基金直接持有公司 10.40%的股份。合肥

市国资委通过合肥颀中控股和芯屏基金能够决定公司 43.80%的股份表决权，系发行人的实际控制人。

截至募集说明书签署日，合肥颀中控股的基本情况如下：

公司名称	合肥颀中科技控股有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2RLAL27R
类型	其他有限责任公司
注册地址	合肥市新站区大禹路 98 号合肥奕斯伟材料技术有限公司 2 层办公区
法定代表人	朱晓玲
注册资本	170,001.00 万元人民币
成立日期	2018 年 4 月 4 日
营业期限	2018 年 4 月 4 日至无固定期限
主营业务	控股型公司，无实际经营业务
经营状态	存续（在营、开业、在册）
与发行人主营业务关系	无

截至募集说明书签署日，合肥颀中控股的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	合肥奕斯伟封测投资中心合伙企业（有限合伙）	170,000.00	99.9994
2	合肥奕斯伟投资有限公司	1.00	0.0006
合计		170,001.00	100.00

合肥颀中控股最近一年的简要财务数据（经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）如下：

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日
总资产	765,575.90
净资产	650,323.16
营业收入	210,111.71
净利润	22,997.15

（二）上市以来控股股东、实际控制人变化情况

公司于 2023 年 4 月在上海证券交易所科创板上市。公司自上市以来，控股

股东、实际控制人均未发生变化。

（三）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份被质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或潜在纠纷的情况。

（四）控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况

发行人控股股东合肥顾中控股控制的除发行人及其子公司以外的企业仅有合肥顾材科技有限公司。

截至募集说明书签署日，根据现行有效的《营业执照》，合肥顾材科技有限公司的基本情况如下：

名称	合肥顾材科技有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2REY6F5K
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	107,331.89977 万元
法定代表人	张莹
成立日期	2018 年 1 月 2 日
经营期限	2018 年 1 月 2 日至 2048 年 1 月 1 日
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内
经营范围	电子专用材料、元件及组件的制造与销售；房屋、生产设备、车辆出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；半导体行业相关材料的技术开发、转让、咨询和服务；企业管理咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人合肥市国资委控制的一级子企业基本情况如下：

序号	企业名称	成立时间	经营范围
1	合肥建投	2006-06-16	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权

序号	企业名称	成立时间	经营范围
			的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
2	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	2015-04-01	政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与收购，企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	1999-01-18	对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
4	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	2007-03-16	基础设施、基础产业及功能性公益性项目投资、融资、建设、运营、管理；整理和熟化经营土地；环境治理、环保景观建设；旅游开发；房地产开发、销售、租赁；公共交通。（以上项目涉及前置许可凭许可证经营）
5	合肥建翔投资有限公司	2013-01-09	项目投资。

截至 2025 年 6 月 30 日，合肥建投控制的一级子企业基本情况如下：

序号	企业名称	成立时间	经营范围
1	合肥交通投资控股集团有限公司	2004-02-11	公路项目建设、营运、收费、咨询及服务；城乡交通基础设施及相关产业的投资与运营；营运授权范围内的国有资产；按照法定程序处置、租赁所属企业土地和房屋资产；国内广告制作、代理、发布；公路服务区经营、策划及住宿、餐饮服务；车辆救援服务及汽车维修；交通工程物资销售；道路普通货运；仓储服务（不含危险品）；实业投资；旅游项目的投资开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	合肥建新投资有限公司	2020-02-20	项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	合肥建长股权投资合伙企业（有限合伙）	2024-11-05	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
4	合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）	2014-10-21	投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	合肥建投投促股权投资合伙企业（有限合伙）	2024-12-26	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6	合肥建投资本管理有限公司	2016-01-11	投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	合肥市投资促进有限公司	2024-09-12	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；科技中介

序号	企业名称	成立时间	经营范围
			服务；软件开发；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8	合肥国有资本创业投资有限公司	2024-06-04	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9	合肥融科项目投资有限公司	2010-11-11	项目投资。
10	合肥文旅博览集团有限公司	2002-04-30	高端现代服务业投融资平台研发；文化体育产业策划、投资、运营管理；旅游产业策划、投资、运营管理；会展场馆运营、展会开发、广告搭建及展会综合配套服务；酒店投资运营及受托管理；餐饮管理；物业管理；教育投资及咨询；大健康产业、休闲养老产业投资建设运营管理；公益设施、基本建设项目开发、经营、融资管理；资产经营管理；投资管理；房地产综合开发、销售；供应链管理；电子商务、农业支撑服务；中介服务；房屋、停车场租赁、管理；企业管理咨询；信息技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	2016-01-18	投资管理、资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	合肥市安居控股集团股份有限公司	2020-05-18	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；互联网信息服务；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；旅游业务；烟草制品零售；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；酒店管理；物业管理；停车场服务；广告发布；园林绿化工程施工；日用品出租；计算机系统服务；网络技术服务；市场营销策划；园区管理服务；文化用品设备出租；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；棋牌室服务；商业综合体管理服务；家政服务；家具安装和维修服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

序号	企业名称	成立时间	经营范围
			外卖递送服务；家用电器修理；家用电器安装服务；日用百货销售；土地整治服务；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
13	合肥中科微电子创新中心有限公司	2021-11-02	一般项目：集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
14	合肥科融高科技产业投资有限公司	2009-11-10	高科技产业风险投资，企业参股、并购及重组，项目投资及运营，股权管理（以上涉及许可的凭许可证经营）。
15	合肥法务区运营管理有限公司	2023-08-30	一般项目：园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；会议及展览服务；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；法律咨询（不含依法须经批准的项目许可的业务）；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业管理咨询；企业管理；创业空间服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
16	合肥市轨道交通集团有限公司	2009-06-02	许可项目：城市公共交通；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产咨询；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
17	合肥蓝科投资有限公司	2008-11-05	项目投资；基础设施建设；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；房产租赁；仓储（除危险品）物流；房地产开发及经营；科技工业园开发及管理；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	合肥瀚屏投资合伙企业（有限合伙）	2017-07-21	投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

序号	企业名称	成立时间	经营范围
			务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
19	合肥市建庐建设投资有限公司	2017-12-21	县域基础设施项目投资、建设、运营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
20	合肥百货大楼集团股份有限公司	1996-07-29	一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);塑料制品销售;美发饰品销售;茶具销售;箱包销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家具销售;食用农产品批发;食用农产品零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;劳动保护用品销售;通信设备销售;移动通信设备销售;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子产品销售;货物进出口;食品进出口;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;金银制品销售;服装制造;服饰制造;鞋制造;塑料制品制造;住房租赁;非居住房地产租赁;玩具、动漫及游艺用品销售;停车场服务;化妆品批发;化妆品零售;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);柜台、摊位出租;商业综合体管理服务;采购代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;眼镜销售(不含隐形眼镜)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品生产;食品销售;酒类经营;烟草制品零售;药品零售;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;基础电信业务;游艺娱乐活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
21	合肥城建投资控股有限公司	2001-12-06	城市建设项目开发和经营,房地产综合开发,对项目和企业进行投资,参股和收购,物资贸易(国家限制和许可证的除外),房屋租赁。
22	合肥晶合集成电路股份有限公司	2015-05-19	集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
23	合肥市智慧泊车产业集团有限公司	2023-04-21	许可项目:建设工程施工;建设工程设计;互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;物业管理;信息系统集成服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨

序号	企业名称	成立时间	经营范围
			询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；软件销售；软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车拖车、求援、清障服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；以自有资金从事投资活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；交通设施维修；物联网技术研发；物联网设备销售；企业管理；企业管理咨询；洗车服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理服务；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
24	合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）	2020-05-28	投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25	合肥市智慧交通投资运营有限公司	2016-12-23	许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；检验检测服务；特种设备检验检测；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；物业管理；住房租赁；园区管理服务；节能管理服务；照明器具销售；灯具销售；照明器具生产专用设备制造；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；共享自行车服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；智能机器人销售；智能控制系统集成；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统制造；汽车零配件零售；机械电气设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络设备制造；网络设备销售；交通设施维修；电子产品销售；通讯设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；信息系统集成服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人

序号	企业名称	成立时间	经营范围
			工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；地理遥感信息服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
26	合肥市建设投资有限公司	1992-04-15	项目投资、股权投资、资产重组及并购（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
27	合肥市乡村振兴投资有限责任公司	2013-01-09	许可项目：房地产开发经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品零售；粮食收购；粮油仓储服务；食品销售（仅销售预包装食品）；土地整治服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
28	合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）	2020-07-30	创业投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
29	合肥市引江济淮投资有限公司	2017-08-30	引江济淮主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营；产业投资、项目建设、项目管理与运营；股权投资；文化旅游、休闲、养老、健康产业的物业投资、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
30	合肥建投城更一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2024-03-26	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
31	合肥金太阳能源科技股份有限公司	2010-12-30	大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。（涉及行政许可的须取得许可证件后方可经营）
32	合肥市种业之都建设及科技强农发展	2023-4-12	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完

序号	企业名称	成立时间	经营范围
	基金合伙企业（有限合伙）		成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2025 年 6 月 30 日，芯屏基金无实际控制的企业。

第四节 财务会计信息与管理层分析

公司提请投资者注意，本节分析与讨论应结合公司财务报告和审计报告全文，以及募集说明书的其他信息一并阅读。

一、最近三年及一期审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

上市公司 2022 年、2023 年、2024 年的财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“天职业字[2023]4837 号”、“天职业字[2024]4001 号”、“天职业字[2025]5905 号”标准无保留意见的审计报告。2025 年 1-6 月财务会计数据未经审计。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重要事项判断标准为：根据自身所处的行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。公司 2022 年、2023 年合并报表层次重要性水平为公司合并报表经常性业务税前利润的 5%，2024 年、2025 年 1-6 月合并报表层次重要性水平为公司合并报表经常性业务税前利润的 7.5%。

二、最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元				
项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	1,046,501,778.55	984,490,583.43	2,142,593,988.57	652,362,600.61
交易性金融资产	229,423,930.14	517,027,707.18	144,021,461.92	111,767,086.68
应收账款	224,345,999.95	200,968,049.89	168,225,129.65	71,808,385.99
预付款项	2,148,162.25	2,586,944.81	4,877,799.34	5,318,417.35
其他应收款	53,490,671.92	68,754,399.39	48,959,788.94	49,422,226.64
其中：应收利息	-	-	1,544,593.26	1,721,977.92

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
存货	536,807,943.72	468,474,132.37	408,214,173.66	361,735,951.19
其他流动资产	130,313,988.24	113,079,189.60	69,190,661.32	21,149,315.19
流动资产合计	2,223,032,474.77	2,355,381,006.67	2,986,083,003.40	1,273,563,983.65
非流动资产：				
固定资产	3,410,759,258.11	3,145,646,496.95	2,520,150,754.85	2,204,879,648.95
在建工程	205,480,428.64	387,100,403.51	565,272,472.22	274,032,420.27
使用权资产	8,385,951.69	8,643,494.45	613,835.69	1,376,266.76
无形资产	158,777,250.46	162,117,160.68	165,964,020.11	168,703,447.19
商誉	872,738,377.16	872,738,377.16	872,738,377.16	872,738,377.16
长期待摊费用	2,196,782.60	2,033,033.21	1,506,713.71	1,685,465.76
递延所得税资产	37,197,712.75	33,706,867.24	25,047,492.26	21,515,096.98
其他非流动资产	11,709,059.17	23,646,818.81	15,956,940.23	4,575,670.45
非流动资产合计	4,707,244,820.58	4,635,632,652.01	4,167,250,606.23	3,549,506,393.52
资产总计	6,930,277,295.35	6,991,013,658.68	7,153,333,609.63	4,823,070,377.17
流动负债：				
短期借款	146,030,834.57	135,963,108.63	121,023,498.27	333,323,809.08
应付账款	266,171,408.12	314,678,796.67	492,673,101.82	230,956,410.01
合同负债	46,803,612.73	50,532,220.05	30,503,495.85	87,473,785.25
应付职工薪酬	40,707,836.37	70,641,541.97	65,144,798.91	52,003,979.96
应交税费	16,887,115.80	18,457,186.52	14,390,570.44	3,894,309.27
其他应付款	25,327,957.92	28,326,351.34	25,642,015.58	14,599,428.15
一年内到期的非流动负债	107,295,079.70	91,825,386.46	222,550,126.96	1,479,888.84
其他流动负债	2,558,463.96	2,367,764.62	2,427,979.39	1,734,836.08
流动负债合计	651,782,309.17	712,792,356.26	974,355,587.22	725,466,446.64
非流动负债：				
长期借款	151,484,000.00	219,780,800.00	309,189,032.14	815,208,028.81
租赁负债	4,760,480.04	5,152,190.39	-	-
递延收益	9,374,900.00	10,000,000.00	-	17,893,158.81
递延所得税负债	38,973,533.14	39,996,289.83	39,662,221.33	41,257,685.64
非流动负债合计	204,592,913.18	274,929,280.22	348,851,253.47	874,358,873.26
负债合计	856,375,222.35	987,721,636.48	1,323,206,840.69	1,599,825,319.90
股东权益：				

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
股本	1,189,037,288.00	1,189,037,288.00	1,189,037,288.00	989,037,288.00
资本公积	3,564,622,621.02	3,533,641,481.50	3,495,738,875.58	1,460,795,863.41
其他综合收益	2,547,601.14	2,658,227.86	2,316,957.89	1,947,674.14
盈余公积	32,660,250.51	32,660,250.51	15,296,452.25	10,295,546.35
未分配利润	1,285,034,312.33	1,245,294,774.33	1,127,737,195.22	761,168,685.37
归属于母公司股东权益合计	6,073,902,073.00	6,003,292,022.20	5,830,126,768.94	3,223,245,057.27
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	6,073,902,073.00	6,003,292,022.20	5,830,126,768.94	3,223,245,057.27
负债及股东权益合计	6,930,277,295.35	6,991,013,658.68	7,153,333,609.63	4,823,070,377.17

（二）合并利润表

单位：元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	995,760,921.23	1,959,375,628.33	1,629,340,035.50	1,317,063,145.81
其中：营业收入	995,760,921.23	1,959,375,628.33	1,629,340,035.50	1,317,063,145.81
二、营业总成本	888,285,499.83	1,628,598,277.28	1,254,237,677.75	1,003,914,692.95
其中：营业成本	720,402,686.68	1,346,577,141.81	1,047,399,156.91	797,970,645.17
税金及附加	10,889,838.90	16,460,344.91	12,655,529.04	5,848,397.45
销售费用	7,790,851.45	14,790,575.27	10,285,405.21	10,135,792.02
管理费用	61,254,787.49	118,490,191.95	99,754,307.05	71,917,062.99
研发费用	92,310,723.82	154,686,627.28	106,294,341.88	99,911,008.58
财务费用	-4,363,388.51	-22,406,603.94	-22,151,062.34	18,131,786.74
其中：利息费用	5,217,297.78	9,698,475.28	21,420,761.99	42,082,610.70
利息收入	9,670,862.19	31,949,821.35	41,427,147.17	11,088,146.28
加：其他收益	9,829,368.21	52,911,798.27	47,440,798.31	17,899,332.37
投资收益（损失以“－”号填列）	5,341,800.55	6,745,737.84	4,776,155.17	4,861,752.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	423,930.14	1,100,707.18	21,461.92	77,086.68
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-82,987.54	-397,619.20	-1,101,277.59	584,949.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,864,163.79	-21,060,535.11	-3,745,972.28	-6,715,358.50

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
列)				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,613,141.37	1,003,877.65	-	-889.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,510,227.60	371,081,317.68	422,493,523.28	329,855,325.35
加：营业外收入	1,067,166.24	439,179.37	2,810,497.09	8,657,911.04
减：营业外支出	837,293.89	2,498,447.79	6,635,176.05	730,616.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,740,099.95	369,022,049.26	418,668,844.32	337,782,619.45
减：所得税费用	13,548,697.55	55,745,078.69	47,006,335.68	34,607,576.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,191,402.40	313,276,970.57	371,662,508.64	303,175,043.33
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,191,402.40	313,276,970.57	371,662,508.64	303,175,043.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）	99,191,402.40	313,276,970.57	371,662,508.64	303,175,043.33
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-110,626.72	341,269.97	369,283.75	1,407,807.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,626.72	341,269.97	369,283.75	1,407,807.03
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	99,080,775.68	313,618,240.54	372,031,792.39	304,582,850.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,080,775.68	313,618,240.54	372,031,792.39	304,582,850.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.26	0.33	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.26	0.33	0.31

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,057,183.89	2,099,353,198.26	1,610,589,963.18	1,603,992,032.91
收到的税费返还	4,475,190.06	27,325,010.80	33,803,443.51	32,008,808.08
收到其他与经营活动有关的现金	129,065,713.19	279,484,933.03	243,014,408.39	99,835,614.26
经营活动现金流入小计	1,214,598,087.14	2,406,163,142.09	1,887,407,815.08	1,735,836,455.25
购买商品、接受劳务支付的现金	559,051,720.58	978,107,227.09	762,102,196.36	533,523,775.95
支付给职工以及为职工支付的现金	255,048,858.64	394,619,227.17	311,319,875.11	303,352,601.40
支付的各项税费	38,728,282.48	74,170,635.05	69,585,042.07	61,241,161.20
支付其他与经营活动有关的现金	127,578,231.81	268,919,362.08	203,125,532.93	136,315,125.44
经营活动现金流出小计	980,407,093.51	1,715,816,451.39	1,346,132,646.47	1,034,432,663.99
经营活动产生的现金流量净额	234,190,993.63	690,346,690.70	541,275,168.61	701,403,791.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,629,805,707.18	5,896,355,461.92	1,040,100,000.00	1,345,900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,341,800.55	6,745,737.84	4,853,241.85	4,861,752.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739,317.81	1,399,000.00	-	30,550.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	8,560,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	4,635,886,825.54	5,913,060,199.76	1,044,953,241.85	1,350,792,302.29
购建固定资产、无	357,130,695.46	1,083,414,416.35	735,321,421.11	394,051,547.43

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	4,341,778,000.00	6,268,261,000.00	1,072,410,000.00	1,437,590,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	8,560,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	4,698,908,695.46	7,360,235,416.35	1,807,731,421.11	1,831,641,547.43
投资活动产生的现金流量净额	-63,021,869.92	-1,447,175,216.59	-762,778,179.26	-480,849,245.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	2,265,600,000.00	-
取得借款收到的现金	51,064,000.00	179,453,800.00	174,978,471.54	650,647,207.26
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	51,064,000.00	179,453,800.00	2,440,578,471.54	650,647,207.26
偿还债务支付的现金	94,455,352.14	386,666,719.30	670,037,988.91	734,316,886.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,317,915.21	192,977,162.33	30,167,241.92	50,462,746.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,517,625.38	3,807,744.21	31,277,521.07	7,051,711.41
筹资活动现金流出小计	160,290,892.73	583,451,625.84	731,482,751.90	791,831,344.19
筹资活动产生的现金流量净额	-109,226,892.73	-403,997,825.84	1,709,095,719.64	-141,184,136.93
四、汇率变动对现金的影响	-70,872.96	759,729.22	2,638,678.97	14,525,187.04
五、现金及现金等价物净增加额	61,871,358.02	-1,160,066,622.51	1,490,231,387.96	93,895,596.23
加：期初现金及现金等价物的余额	982,527,366.06	2,142,593,988.57	652,362,600.61	558,467,004.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,398,724.08	982,527,366.06	2,142,593,988.57	652,362,600.61

三、发行人财务报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础及遵循会计准则的声明

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

（二）合并财务报表范围

公司报告期纳入合并财务报表范围的子公司共 2 家，具体包括：

公司全称	子公司类型	报告期末持股比例（%）	报告期末表决权比例（%）
颀中科技（苏州）有限公司	公司全资一级子公司	100.00	100.00
颀中国际贸易有限公司	公司全资二级子公司	100.00	100.00

报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

四、主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年 度	2023 年 12 月 31 日/2023 年 度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额（万元）	693,027.73	699,101.37	715,333.36	482,307.04
归属于母公司所有者权益（万元）	607,390.21	600,329.20	583,012.68	322,324.51
流动比率（倍）	3.41	3.30	3.06	1.76
速动比率（倍）	2.59	2.65	2.65	1.26
资产负债率（母公司）	6.37%	2.44%	3.28%	3.67%
资产负债率（合并）	12.36%	14.13%	18.50%	33.17%
利息保障倍数（倍）	22.61	39.05	20.55	9.03
应收账款周转率（次/年）	9.36	10.61	13.58	10.71
存货周转率（次/年）	2.87	3.07	2.72	2.36
归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,919.14	31,327.70	37,166.25	30,317.50
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,652.45	27,667.68	33,968.54	27,112.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20	0.58	0.46	0.71
每股净现金流量（元/股）	0.05	-0.98	1.25	0.09

项目	2025年6月 30日/2025年 1-6月	2024年12月 31日/2024年 度	2023年12月 31日/2023年 度	2022年12月 31日/2022 年度
归属于母公司所有者的每股 净资产（元/股）	5.11	5.05	4.90	3.26

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/总资产；
- 4、利息保障倍数=（利润总额+利息支出（财务费用项下））/利息支出（财务费用项下）；
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值（2025年1-6月数据已年化）；
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值（2025年1-6月数据已年化）；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；
- 9、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额。

（二）每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，报告期公司净资产收益率及每股收益如下：

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益	
			基本每股收 益（元/股）	稀释每股收 益（元/股）
2025年 1-6月	归属于母公司所有者的净利润	1.64	0.08	0.08
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1.59	0.08	0.08
2024年度	归属于母公司所有者的净利润	5.29	0.26	0.26
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4.67	0.23	0.23
2023年度	归属于母公司所有者的净利润	7.59	0.33	0.33
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	6.93	0.30	0.30
2022年度	归属于母公司所有者的净利润	9.88	0.31	0.31
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8.84	0.27	0.27

基本每股收益= $P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

（其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。）

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

（其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。）

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + N_P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

（其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；N_P 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。）

（三）非经常性损益明细表

以下非经常性损益以合并财务报表数据为基础，并经天职国际出具的《合肥
顾中科技股份有限公司非经常性损益明细审核报告》（天职业字[2025] 35380 号）
核验。报告期公司非经常性损益具体内容、金额明细如下：

单位：万元				
非经常性损益明细	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益	-434.42	49.24	-	-3.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	74.46	3,859.96	4,203.15	3,472.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	576.57	784.64	479.76	493.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96.09	-154.78	-662.47	-69.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21.81	14.43	12.85	9.43
非经常性损益合计	334.51	4,553.50	4,033.29	3,903.69
减：所得税影响金额	67.83	893.48	835.58	698.45
扣除所得税影响后的非经常性损益	266.69	3,660.02	3,197.71	3,205.23
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	266.69	3,660.02	3,197.71	3,205.23
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-	-

报告期各期，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 3,205.23 万元、3,197.71 万元、3,660.02 万元和 266.69 万元。公司聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，持续得到政府部门的重点支持，报告期内，计入当期损益的政府补

助是公司非经常性损益的主要组成部分。

随着公司生产规模逐年扩大，报告期内，公司营业收入规模持续增长且经营活动产生的现金流量情况良好，总体而言，报告期内公司非经常性损益对经营成果不存在重大影响。

五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正

（一）会计政策变更

1、2022 年度

公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，以及“关于亏损合同的判断”内容，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，以及“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

2、2023 年度

公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税资产	93,946.00
执行《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税负债	187,038.89
执行《企业会计准则解释第 16 号》	未分配利润	-93,092.89

执行《企业会计准则解释第 16 号》	所得税费用	93,092.89
--------------------	-------	-----------

3、2024 年度

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自规定之日起开始执行。执行解释 17 号的相关规定对公司报告期内财务报表无影响。

2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“解释第 18 号”），自印发之日起施行。公司自规定之日起开始执行。执行解释 18 号的相关规定对公司报告期内财务报表无影响。

（二）会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

六、主要税种和税率

（一）主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务或不动产租赁服务等	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
印花税	按国家法定标准	
房产税	房产原值一次减去 30%后的余值	1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	1.5 元/平方米/年、5 元/平方米/年
环境保护税	按国家法定标准	
车船税	按国家法定标准	

执行不同企业所得税税率纳税主体的情况说明如下：

纳税主体名称	企业所得税税率
--------	---------

合肥颀中科技股份有限公司	25.00%
颀中科技（苏州）有限公司	15.00%
颀中国际贸易有限公司	16.50%

注：颀中国际贸易有限公司系在香港设立的离岸公司，享受免征企业所得税。

（二）重要税收优惠政策及其依据

公司一级子公司颀中科技（苏州）有限公司已取得证书编号为 GR202332004292 的《高新技术企业证书》，有效期自 2023 年 11 月 06 日至 2026 年 11 月 06 日，执行 15%企业所得税税率；取得证书编号为 GR202032004760 的《高新技术企业证书》，有效期自 2020 年 12 月 02 日至 2023 年 12 月 02 日，执行 15%企业所得税税率。

公司二级子公司颀中国际贸易有限公司系在香港设立的离岸公司，享受免征企业所得税。

颀中科技（苏州）有限公司具有进出口经营权，出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策，退税率为 13%。

财政部国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知（财税〔2000〕125 号）对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房，包括企业和自收自支事业单位向职工出租的单位自有住房；房管部门向居民出租的公有住房；落实私房政策中带户发还产权并以政府规定租金标准向居民出租的私有住房等，暂免征收房产税。

财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额，出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策，其对应的进项税额不得计提加计抵减额。

七、财务状况分析

（一）资产构成及其变动情况

报告期各期末，公司资产构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	222,303.25	32.08%	235,538.10	33.69%	298,608.30	41.74%	127,356.40	26.41%
非流动资产	470,724.48	67.92%	463,563.27	66.31%	416,725.06	58.26%	354,950.64	73.59%
资产总计	693,027.73	100.00%	699,101.37	100.00%	715,333.36	100.00%	482,307.04	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 482,307.04 万元、715,333.36 万元、699,101.37 万元和 693,027.73 万元。其中，流动资产占资产总额的比例分别为 26.41%、41.74%、33.69%和 32.08%，非流动资产占资产总额的比例分别为 73.59%、58.26%、66.31%和 67.92%。公司非流动资产占比较高，符合公司资本密集型、技术密集型的行业特征。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	104,650.18	47.08%	98,449.06	41.80%	214,259.40	71.75%	65,236.26	51.22%
交易性金融资产	22,942.39	10.32%	51,702.77	21.95%	14,402.15	4.82%	11,176.71	8.78%
应收账款	22,434.60	10.09%	20,096.80	8.53%	16,822.51	5.63%	7,180.84	5.64%
预付款项	214.82	0.10%	258.69	0.11%	487.78	0.16%	531.84	0.42%
其他应收款	5,349.07	2.41%	6,875.44	2.92%	4,895.98	1.64%	4,942.22	3.88%
存货	53,680.79	24.15%	46,847.41	19.89%	40,821.42	13.67%	36,173.60	28.40%
其他流动资产	13,031.40	5.86%	11,307.92	4.80%	6,919.07	2.32%	2,114.93	1.66%
流动资产合计	222,303.25	100.00%	235,538.10	100.00%	298,608.30	100.00%	127,356.40	100.00%

报告期各期末，公司的流动资产总额分别为 127,356.40 万元、298,608.30 万元、235,538.10 万元和 222,303.25 万元。2023 年末，公司流动资产规模较 2022 年末大幅增长，主要系公司于 2023 年完成首次公开发行股票并上市，募集资金到位使得公司货币资金余额增加。2024 年末，公司流动资产规模较 2023 年末有所下降，主要系公司 2024 年度偿还部分银行借款使得货币资金规模减少所致。

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	74,659.95	75,748.07	177,452.57	25,607.69
其他货币资金	29,779.92	22,504.66	36,806.83	39,628.57
未到期应收利息	210.31	196.32	-	-
合计	104,650.18	98,449.06	214,259.40	65,236.26
其中：存放在境外的 款项总额	21,199.69	17,766.82	17,415.89	8,775.42

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 65,236.26 万元、214,259.40 万元、98,449.06 万元和 104,650.18 万元。其中，其他货币资金主要系七天通知存款、三个月以内的定期存款，未到期应收利息主要为银行存款的应收利息。2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末大幅增长，主要系公司于 2023 年完成首次公开发行股票并上市取得募集资金。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	22,942.39	51,702.77	14,402.15	11,176.71
合计	22,942.39	51,702.77	14,402.15	11,176.71

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 11,176.71 万元、14,402.15 万元、51,702.77 万元和 22,942.39 万元，主要系公司为提高资金使用效率而购买的结构性存款等理财产品。

（3）应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款余额	22,661.21	20,299.80	17,008.32	7,254.07
减：预期信用损失	226.61	203.00	185.81	73.23

项目	2025年 6月30日	2024年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
应收账款账面价值	22,434.60	20,096.80	16,822.51	7,180.84

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,180.84 万元、16,822.51 万元、20,096.80 万元和 22,434.60 万元。2023 年末，公司应收账款余额较 2022 年末增幅较大，主要系受终端需求回暖等因素影响，公司 2023 年第四季度收入同比增长 43.30%，收入规模扩大导致 2023 年末应收账款余额有所增加。

1) 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

2025年6月30日					
类别	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,661.21	100.00%	226.61	1.00%	22,434.60
合计	22,661.21	100.00%	226.61	1.00%	22,434.60
2024年12月31日					
类别	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,299.80	100.00%	203.00	1.00%	20,096.80
合计	20,299.80	100.00%	203.00	1.00%	20,096.80
2023年12月31日					
类别	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,008.32	100.00%	185.81	1.09%	16,822.51
合计	17,008.32	100.00%	185.81	1.09%	16,822.51
2022年12月31日					
类别	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,254.07	100.00%	73.23	1.01%	7,180.84
合计	7,254.07	100.00%	73.23	1.01%	7,180.84

2) 应收账款余额按账龄划分

报告期各期末，公司应收账款余额的账龄分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
3 个月以内 (含 3 个月)	22,661.21	100.00%	20,299.80	100.00%	16,632.07	97.79%	7,236.96	99.76%
3 个月-1 年 (含 1 年)	-	-	-	-	376.25	2.21%	17.11	0.24%
应收账款账 面余额	22,661.21	100.00%	20,299.80	100.00%	17,008.32	100.00%	7,254.07	100.00%

从应收账款账龄结构来看，报告期各期末，公司应收账款账龄在 3 个月以内的比例较高，占各期末应收账款账面余额比例分别为 99.76%、97.79%、100.00% 和 100.00%，应收账款账龄较短。

3) 应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五大客户情况如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	金额	占应收账款余 额比例
2025 年 6 月 30 日	1	格科微	4,712.87	20.80%
	2	奕斯伟计算	4,091.74	18.06%
	3	客户 A	3,547.65	15.66%
	4	联咏科技	1,702.65	7.51%
	5	瑞鼎科技	1,577.95	6.96%
		合计	15,632.87	68.99%
2024 年 12 月 31 日	1	客户 A	4,344.05	21.40%
	2	奕斯伟计算	3,354.47	16.52%
	3	格科微	2,942.32	14.49%
	4	瑞鼎科技	2,247.63	11.07%
	5	集创北方	1,335.68	6.58%
		合计	14,224.13	70.06%
2023 年 12 月 31 日	1	格科微	3,596.37	21.14%
	2	联咏科技	3,204.76	18.84%
	3	客户 A	2,100.96	12.35%
	4	奕斯伟计算	1,722.31	10.13%

时间	序号	客户名称	金额	占应收账款余额比例
2022 年 12 月 31 日	5	瑞鼎科技	968.95	5.7%
		合计	11,593.34	68.16%
	1	客户 A	2,117.22	29.19%
	2	奕斯伟计算	1,131.12	15.59%
	3	联咏科技	1,038.64	14.32%
	4	格科微	953.65	13.15%
	5	集创北方	883.70	12.18%
		合计	6,124.31	84.43%

注：上述客户应收账款余额统计按照合并口径计算，其中瑞鼎科技包括 Raydium Semiconductor Corporation、昆山瑞创芯电子有限公司；格科微包括格科微电子（上海）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司；集创北方包括 Chipone (Hong Kong) Co. Limited、OLED VICTORY INTERNATIONAL LIMITED、北京集创北方科技股份有限公司；奕斯伟计算包括北京奕斯伟计算技术股份有限公司、西安奕斯伟计算技术有限公司。

（4）预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	203.39	94.68%	256.44	99.13%	475.68	97.52%	531.84	100.00%
1-2 年 (含 2 年)	11.42	5.32%	2.25	0.87%	12.10	2.48%	-	-
合计	214.82	100.00%	258.69	100.00%	487.78	100.00%	531.84	100.00%

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 531.84 万元、487.78 万元、258.69 万元和 214.82 万元，主要系预付租金、保险费等，占流动资产比例较低。

（5）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息	-	-	154.46	172.20
其他应收款	5,402.05	6,943.82	4,787.03	4,817.70
减：坏账准备	52.99	68.38	45.51	47.68

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
合计	5,349.07	6,875.44	4,895.98	4,942.22

报告期各期末，公司扣除应收利息的其他应收款余额分别为 4,817.70 万元、4,787.03 万元、6,943.82 万元和 5,402.05 万元，主要系往来款、保证金及押金。其中，应收客户 A 款项占报告期各期末余额的比例分别为 88.71%、95.06%、98.48% 和 98.08%，系公司根据该客户要求代为采购卷带所形成。

报告期各期末，公司其他应收款账龄构成情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	5,315.68	98.40%	6,857.45	98.76%	4,768.52	99.61%	4,796.32	99.56%
1-2 年(含 2 年)	65.67	1.22%	74.20	1.07%	0.25	0.01%	10.17	0.21%
2-3 年(含 3 年)	8.54	0.16%	-	-	10.17	0.21%	8.48	0.18%
3 年以上	12.17	0.23%	12.17	0.18%	8.09	0.17%	2.74	0.06%
合计	5,402.05	100.00%	6,943.82	100.00%	4,787.03	100.00%	4,817.70	100.00%

从账龄结构来看，报告期各期末，公司其他应收款账龄在 1 年以内的比例较高，占各期末其他应收款账面余额比例分别为 99.56%、99.61%、98.76%和 98.40%，其他应收款账龄整体相对较短。

(6) 存货

报告期各期末，公司存货的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
2025 年 6 月 30 日				
原材料	35,083.19	63.54%	1,192.02	33,891.17
在产品	4,556.62	8.25%	114.81	4,441.82
库存商品	15,575.27	28.21%	229.97	15,345.30
低值易耗品	2.51	0.01%	-	2.51
合计	55,217.59	100.00%	1,536.80	53,680.79
2024 年 12 月 31 日				
原材料	30,149.25	61.06%	1,118.86	29,030.39

项目	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
在产品	7,329.89	14.84%	192.20	7,137.69
库存商品	11,890.32	24.08%	1,220.79	10,669.53
低值易耗品	9.81	0.02%	-	9.81
合计	49,379.26	100.00%	2,531.84	46,847.41

2023 年 12 月 31 日

原材料	23,521.39	56.37%	905.25	22,616.13
在产品	7,506.91	17.99%	-	7,506.91
库存商品	10,635.79	25.49%	-	10,635.79
低值易耗品	62.58	0.15%	-	62.58
合计	41,726.67	100.00%	905.25	40,821.42

2022 年 12 月 31 日

原材料	18,787.21	50.52%	1,015.47	17,771.74
在产品	7,429.36	19.98%	-	7,429.36
库存商品	10,965.37	29.49%	-	10,965.37
低值易耗品	7.13	0.02%	-	7.13
合计	37,189.06	100.00%	1,015.47	36,173.60

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 36,173.60 万元、40,821.42 万元、46,847.41 万元和 53,680.79 万元，公司存货主要由原材料、库存商品和在产品构成。报告期内，公司业务规模持续扩大，原材料备货增加，同时库存商品余额总体呈上升趋势，与公司营业收入增长趋势一致。

公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 1,015.47 万元、905.25 万元、2,531.84 万元和 1,536.80 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
存货账面余额	55,217.59	49,379.26	41,726.67	37,189.06
存货跌价准备	1,536.80	2,531.84	905.25	1,015.47
存货账面价值	53,680.79	46,847.41	40,821.42	36,173.60
存货跌价准备计提比例	2.78%	5.13%	2.17%	2.73%

公司 2024 年末存货跌价准备计提比例有所上升，主要系合肥工厂投资规模

较大，量产初期设备折旧金额较高，产能利用率正在爬坡，导致合肥工厂部分库存商品和在产品的可变现净值低于成本，公司对其计提了存货跌价准备，使得2024年末公司存货跌价准备金额有所上升。

（7）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元				
项目	2025年 6月30日	2024年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
增值税进项留抵	12,298.83	10,617.18	6,624.95	1,155.46
待摊费用	732.57	690.74	47.44	-
预缴企业所得税	-	-	246.68	511.15
预付IPO中介机构款	-	-	-	448.32
合计	13,031.40	11,307.92	6,919.07	2,114.93

报告期各期末，公司其他流动资产分别为2,114.93万元、6,919.07万元、11,307.92万元和13,031.40万元。其中，增值税进项留抵金额较大且逐年增加，主要系公司报告期内持续购置机器设备所致。

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元								
项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	341,075.93	72.46%	314,564.65	67.86%	252,015.08	60.48%	220,487.96	62.12%
在建工程	20,548.04	4.37%	38,710.04	8.35%	56,527.25	13.56%	27,403.24	7.72%
使用权资产	838.60	0.18%	864.35	0.19%	61.38	0.01%	137.63	0.04%
无形资产	15,877.73	3.37%	16,211.72	3.50%	16,596.40	3.98%	16,870.34	4.75%
商誉	87,273.84	18.54%	87,273.84	18.83%	87,273.84	20.94%	87,273.84	24.59%
长期待摊费用	219.68	0.05%	203.30	0.04%	150.67	0.04%	168.55	0.05%
递延所得税资产	3,719.77	0.79%	3,370.69	0.73%	2,504.75	0.60%	2,151.51	0.61%
其他非流动资产	1,170.91	0.25%	2,364.68	0.51%	1,595.69	0.38%	457.57	0.13%
非流动资产合计	470,724.48	100.00%	463,563.27	100.00%	416,725.06	100.00%	354,950.64	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产总额分别为354,950.64万元、416,725.06万

元、463,563.27 万元和 470,724.48 万元。公司非流动资产逐年增加，主要系公司业务规模扩张，生产设备投入增加所致。

(1) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
账面原值合计	588,426.24	100.00%	542,580.57	100.00%	442,459.90	100.00%	384,304.11	100.00%
房屋建筑物	93,771.67	15.94%	91,395.81	16.84%	88,071.39	19.90%	57,648.03	15.00%
机器设备	477,896.14	81.22%	434,072.83	80.00%	341,077.35	77.09%	315,277.25	82.04%
运输工具	275.40	0.05%	275.40	0.05%	131.36	0.03%	117.46	0.03%
办公设备	7,122.69	1.21%	6,936.55	1.28%	5,542.51	1.25%	4,443.79	1.16%
其他设备	9,360.34	1.59%	9,899.98	1.82%	7,637.29	1.73%	6,817.58	1.77%
累计折旧合计	247,350.32	100.00%	228,015.92	100.00%	190,444.83	100.00%	163,816.14	100.00%
房屋建筑物	24,307.18	9.83%	22,305.78	9.78%	18,486.68	9.71%	15,990.00	9.76%
机器设备	213,411.05	86.28%	195,936.11	85.93%	163,293.53	85.74%	139,735.70	85.30%
运输工具	115.00	0.05%	95.76	0.04%	78.36	0.04%	62.22	0.04%
办公设备	4,409.95	1.78%	4,074.63	1.79%	3,479.92	1.83%	3,126.92	1.91%
其他设备	5,107.14	2.06%	5,603.63	2.46%	5,106.34	2.68%	4,901.30	2.99%
账面价值合计	341,075.93	100.00%	314,564.65	100.00%	252,015.08	100.00%	220,487.96	100.00%
房屋建筑物	69,464.50	20.37%	69,090.03	21.96%	69,584.71	27.61%	41,658.03	18.89%
机器设备	264,485.09	77.54%	238,136.72	75.70%	177,783.82	70.54%	175,541.55	79.62%
运输工具	160.40	0.05%	179.63	0.06%	53.01	0.02%	55.24	0.03%
办公设备	2,712.75	0.80%	2,861.91	0.91%	2,062.59	0.82%	1,316.87	0.60%
其他设备	4,253.20	1.25%	4,296.36	1.37%	2,530.95	1.00%	1,916.28	0.87%

报告期各期末，公司主要固定资产为机器设备，占固定资产账面价值的比例分别为 79.62%、70.54%、75.70%和 77.54%。报告期内，随着公司业务发展、营业收入规模增加以及新项目建设的有序推进，公司固定资产规模呈增长趋势。

报告期各期末，公司固定资产未发生减值。

(2) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成及变动情况如下：

单位：万元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
2025 年 6 月 30 日						
在安装设备	不适用	17,566.18	27,079.54	28,435.23	-	16,210.49
顾中先进封装测试生产基地项目	96,973.75	21,143.86	735.35	17,541.66	-	4,337.55
合计	-	38,710.04	27,814.89	45,976.89	-	20,548.04
2024 年 12 月 31 日						
在安装设备	不适用	28,496.51	49,315.67	60,246.00	-	17,566.18
化合物半导体项目环保设施建设工程	不适用	230.09	-	230.09	-	-
有机排气活性炭吸附工艺改造为沸石转轮及 RCO 工程二期	不适用	328.44	35.52	363.96	-	-
顾中先进封装测试生产基地项目	96,973.75	27,472.21	24,380.78	30,607.91	101.22	21,143.86
合计	-	56,527.25	73,731.98	91,447.97	101.22	38,710.04
2023 年 12 月 31 日						
在安装设备	不适用	12,712.38	43,804.85	28,020.72	-	28,496.51
化合物半导体项目环保设施建设工程	不适用	-	230.09		-	230.09
有机排气活性炭吸附工艺改造为沸石转轮及 RCO 工程二期	不适用	-	328.44		-	328.44
顾中先进封装测试生产基地项目	96,973.75	14,690.87	44,697.79	31,916.45	-	27,472.21
合计	-	27,403.24	89,061.17	59,937.17	-	56,527.25
2022 年 12 月 31 日						
顾中先进封装测试生产基地项目	96,973.75	53.89	14,636.97	-	-	14,690.87
在安装设备	不适用	10,715.82	30,628.78	28,632.22	-	12,712.38
三区宿舍二期工程	5,536.71	4,278.36	1,258.35	5,536.71	-	-
合计	-	15,048.07	46,524.11	34,168.94	-	27,403.24

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 27,403.24 万元、56,527.25 万元、38,710.04 万元和 20,548.04 万元，主要为新增在安装机器设备、员工宿舍建设工程以及顾中先进封装测试生产基地项目。报告期内，随着公司生产规模扩大，

生产所需的机器设备等逐年增加。公司在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产，其中在安装设备将根据安装运行状态陆续达到预定可使用状态并转入固定资产。

报告期各期末，公司在建工程未发生减值。

（3）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋建筑物	838.60	100.00%	864.35	100.00%	61.38	100.00%	137.63	100.00%
合计	838.60	100.00%	864.35	100.00%	61.38	100.00%	137.63	100.00%

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 137.63 万元、61.38 万元、864.35 万元和 838.60 万元。2024 年末，公司使用权资产较上年末增幅较大，主要系厂房租赁增加所致。

（4）无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
土地使用权	15,070.99	94.92%	15,244.70	94.04%	15,579.05	93.87%	15,926.21	94.40%
软件	806.74	5.08%	967.02	5.96%	1,017.35	6.13%	944.14	5.60%
合计	15,877.73	100.00%	16,211.72	100.00%	16,596.40	100.00%	16,870.34	100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 16,870.34 万元、16,596.40 万元、16,211.72 万元和 15,877.73 万元，主要为土地使用权及办公软件、安全系统等外购软件。

报告期内，公司不存在开发支出资本化形成无形资产的情况。报告期各期末，公司无形资产使用情况良好，未出现减值迹象。

（5）商誉

公司商誉系 2018 年收购苏州顾中形成，金额为 87,273.84 万元。北京中企华资产评估有限责任公司对公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的苏州顾中包含商誉的资产组分别在 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的可回收金额进行了评估，并分别出具了中企华评报字（2023）第 3222 号评估报告、中企华评报字（2024）第 3433 号评估报告及中企华评报字（2025）第 6143 号评估报告。报告期各期末，公司包含商誉的资产组可回收价值均高于与商誉相关的资产组账面价值，公司商誉不存在减值迹象，无需计提商誉减值准备。

（6）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
简易家具等	219.68	203.30	150.67	168.55
合计	219.68	203.30	150.67	168.55

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 168.55 万元、150.67 万元、203.30 万元和 219.68 万元，主要系员工宿舍简易家具等形成。

（7）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,299.42	195.10	1,282.61	192.39	1,103.94	165.59	1,125.99	168.90
固定资产账面折旧与税法折旧差异	20,615.88	3,092.38	18,295.10	2,744.26	14,853.77	2,228.07	12,487.52	1,873.13
无形资产账面摊销与税法差异	700.68	105.10	718.55	107.78	736.47	111.09	729.89	109.48
递延收益	1,000.00	150.00	1,000.00	150.00	-	-	-	-
租赁负债税会差异	708.76	177.19	704.99	176.25	-	-	62.63	9.39
合计	24,324.74	3,719.77	22,001.25	3,370.69	16,694.18	2,504.75	14,406.03	2,160.90

报告期各期末，公司递延所得税资产主要系固定资产账面折旧与税法折旧差

异所致，占非流动资产的比例较小。

(8) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月 30日	2024年12月 31日	2023年12月 31日	2022年12月 31日
预付设备款	1,170.91	2,364.68	1,595.69	457.57
合计	1,170.91	2,364.68	1,595.69	457.57

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 457.57 万元、1,595.69 万元、2,364.68 万元和 1,170.91 万元，系公司购置设备预付款项。

(二) 负债构成及其变动情况

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	65,178.23	76.11%	71,279.24	72.17%	97,435.56	73.64%	72,546.64	45.35%
非流动负债	20,459.29	23.89%	27,492.93	27.83%	34,885.13	26.36%	87,435.89	54.65%
负债合计	85,637.52	100.00%	98,772.16	100.00%	132,320.68	100.00%	159,982.53	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 159,982.53 万元、132,320.68 万元、98,772.16 万元和 85,637.52 万元，公司负债总额持续下降，主要系报告期内公司使用经营积累的资金及首发上市募集的补流资金不断偿还银行借款，使得短期借款、长期借款金额持续减少。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成具体如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	14,603.08	22.40%	13,596.31	19.07%	12,102.35	12.42%	33,332.38	45.95%
应付账款	26,617.14	40.84%	31,467.88	44.15%	49,267.31	50.56%	23,095.64	31.84%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合同负债	4,680.36	7.18%	5,053.22	7.09%	3,050.35	3.13%	8,747.38	12.06%
应付职工薪酬	4,070.78	6.25%	7,064.15	9.91%	6,514.48	6.69%	5,200.40	7.17%
应交税费	1,688.71	2.59%	1,845.72	2.59%	1,439.06	1.48%	389.43	0.54%
其他应付款	2,532.80	3.89%	2,832.64	3.97%	2,564.20	2.63%	1,459.94	2.01%
一年内到期的非流动负债	10,729.51	16.46%	9,182.54	12.88%	22,255.01	22.84%	147.99	0.20%
其他流动负债	255.85	0.39%	236.78	0.33%	242.80	0.25%	173.48	0.24%
流动负债合计	65,178.23	100.00%	71,279.24	100.00%	97,435.56	100.00%	72,546.64	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要为短期借款、应付账款、应付职工薪酬和一年内到期的非流动负债等。具体分析如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2025年 6月30日	2024年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
信用借款	14,524.42	13,545.54	12,060.70	33,170.88
短期借款—应付利息	78.66	50.77	41.65	161.50
合计	14,603.08	13,596.31	12,102.35	33,332.38

报告期各期末，公司短期借款金额分别为 33,332.38 万元、12,102.35 万元、13,596.31 万元和 14,603.08 万元。报告期内，公司不存在逾期未偿还的银行借款，并正常支付利息费用。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付账款按账龄分类情况列示如下：

单位：万元

项目	2025年 6月30日	2024年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
1年以内(含1年)	26,373.27	31,357.30	48,635.28	23,032.84
1-2年(含2年)	243.87	110.58	632.03	62.80
合计	26,617.14	31,467.88	49,267.31	23,095.64

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 23,095.64 万元、49,267.31 万元、31,467.88 万元和 26,617.14 万元，主要系公司建造厂房、采购机器设备和原材料的应付款项。2023 年，受首发募投项目建设和产能扩充等因素推动，公司设备采购金额较大，因此期末应付账款余额相对较高。

（3）合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货款	4,680.36	5,053.22	3,050.35	8,747.38
合计	4,680.36	5,053.22	3,050.35	8,747.38

报告期各期末，公司合同负债余额分别为 8,747.38 万元、3,050.35 万元、5,053.22 万元和 4,680.36 万元，系预收客户货款。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	4,070.78	7,064.15	6,500.42	5,199.56
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,005.14	7,010.09	6,453.79	5,168.12
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	-	5.62	0.21
其中：医疗保险费	-	-	5.45	0.15
工伤保险费	-	-	0.17	0.02
生育保险费	-	-	-	0.04
4、住房公积金	26.39	15.31	6.95	2.43
5、工会经费和职工教育经费	39.26	38.75	34.06	28.80
二、离职后福利-设定提存计划	-	-	14.06	0.83
1、基本养老保险	-	-	13.63	0.81
2、失业保险费	-	-	0.43	0.02
合计	4,070.78	7,064.15	6,514.48	5,200.40

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 5,200.40 万元、6,514.48 万元、

7,064.15 万元和 4,070.78 万元，主要系应付职工工资、奖金、津贴和补贴等。

(5) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
企业所得税	994.95	1,458.11	1,119.26	103.68
房产税	225.78	215.18	159.36	126.72
代扣代缴个人所得税	104.84	82.76	68.35	51.46
城市维护建设税	66.52	47.12	48.52	-
教育费附加	28.51	20.19	20.80	-
地方教育附加	19.01	13.46	13.86	-
土地使用税	8.91	8.91	8.91	8.91
增值税	240.20	-	-	98.65
合计	1,688.71	1,845.72	1,439.06	389.43

报告期各期末，公司应交税费分别为 389.43 万元、1,439.06 万元、1,845.72 万元和 1,688.71 万元，主要系企业所得税、房产税和代缴代扣的个人所得税等。

(6) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
往来款	2,284.14	2,567.78	2,308.18	1,310.20
押金、保证金、备用金	99.22	93.89	88.83	88.64
员工生育护理津贴	7.20	12.80	80.00	38.13
其他	142.24	158.17	87.19	22.98
合计	2,532.80	2,832.64	2,564.20	1,459.94

报告期各期末，公司其他应付款分别为 1,459.94 万元、2,564.20 万元、2,832.64 万元和 2,532.80 万元，主要系根据客户要求代为采购卷带所形成的往来款。

(7) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	10,469.11	8,964.96	22,255.01	79.26
一年内到期的租赁负债	260.40	217.58	-	68.73
合计	10,729.51	9,182.54	22,255.01	147.99

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 147.99 万元、22,255.01 万元、9,182.54 万元和 10,729.51 万元，系一年内到期的长期借款和一年内到期的租赁负债。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	255.85	236.78	242.80	173.48
合计	255.85	236.78	242.80	173.48

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 173.48 万元、242.80 万元、236.78 万元和 255.85 万元，系待转销项税额。

2、非流动负债分析

报告期各期末，非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	15,148.40	74.04%	21,978.08	79.94%	30,918.90	88.63%	81,520.80	93.23%
租赁负债	476.05	2.33%	515.22	1.87%	-	-	-	-
递延收益	937.49	4.58%	1,000.00	3.64%	-	-	1,789.32	2.05%
递延所得税负债	3,897.35	19.05%	3,999.63	14.55%	3,966.22	11.37%	4,125.77	4.72%
合计	20,459.29	100.00%	27,492.93	100.00%	34,885.13	100.00%	87,435.89	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债主要由长期借款、递延收益和递延所得税负债等构成。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
信用借款	15,148.40	21,978.08	-	-
抵押借款	-	-	30,918.90	81,520.80
合计	15,148.40	21,978.08	30,918.90	81,520.80

报告期内，公司长期借款金额分别为 81,520.80 万元、30,918.90 万元、21,978.08 万元和 15,148.40 万元。报告期内，公司不存在逾期未偿还的银行借款，并正常支付利息费用。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
房屋租赁	476.05	515.22	-	-
合计	476.05	515.22	-	-

公司租赁负债系厂房租赁所形成。

（3）递延收益

报告期各期末，公司的递延收益余额分别为 1,789.32 万元、0 万元、1,000.00 万元和 937.49 万元，均系公司获得的政府补助，具体如下：

单位：万元

序号	项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
1	合肥新站高新技术产业开发区运营资金补助	-	-	-	1,789.32
2	制造业新型技术改造城市试点支持项目补助	937.49	1,000.00	-	-
合计		937.49	1,000.00	-	1,789.32

（4）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,028.99	3,257.25	13,266.62	3,316.65	13,766.23	3,441.56	14,343.27	3,585.82
享受高新技术企业设备购置一次性扣除应纳税暂时性差异	2,892.15	433.82	3,062.77	459.42	3,404.01	510.60	3,591.97	538.80
交易性金融资产公允价值变动	42.39	6.64	110.07	17.51	2.15	0.54	7.71	1.16
使用权资产税会差异	798.59	199.65	824.18	206.04	54.11	13.53	124.69	18.70
合计	16,762.12	3,897.35	17,263.63	3,999.63	17,226.49	3,966.22	18,067.64	4,144.47

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 4,144.47 万元、3,966.22 万元、3,999.63 万元和 3,897.35 万元，主要系公司收购苏州硕中时因资产评估增值形成应纳税暂时性差异所致。

（三）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期各期末，公司偿债能力指标如下表：

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动比率（倍）	3.41	3.30	3.06	1.76
速动比率（倍）	2.59	2.65	2.65	1.26
资产负债率（合并）	12.36%	14.13%	18.50%	33.17%

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.76、3.06、3.30 和 3.41，速动比率分别为 1.26、2.65、2.65 和 2.59，资产负债率分别为 33.17%、18.50%、14.13% 和 12.36%，流动比率和速动比率持续提升，资产负债率持续下降，主要系：（1）报告期内公司完成首次公开发行，使用首次公开发行募集的补流资金归还银行借款，流动负债规模下降；（2）公司收入持续增长，下游客户回款良好，流动资产有所增长。总体而言，公司流动比率、速动比率较高，资产负债率较低，资产负债结构合理，偿债能力较强。

2、公司偿债能力与同行业可比公司的比较分析

报告期各期末，公司与同行业可比公司偿债能力相关指标对比如下：

项目	公司名称	2025年6月 30日	2024年12月 31日	2023年12月 31日	2022年12月 31日
资产负债率 (%)	晶方科技	13.32	9.28	14.56	12.36
	汇成股份	31.35	30.28	12.91	9.14
	甬矽电子	72.05	70.44	67.58	64.60
	通富微电	61.98	60.06	57.87	59.13
	颀邦科技	14.01	9.40	11.09	19.75
	南茂科技	46.56	44.75	46.16	44.79
	平均值	39.88	37.37	35.03	34.96
	颀中科技	12.36	14.13	18.50	33.17
流动比率 (倍)	晶方科技	4.99	8.09	5.69	5.90
	汇成股份	7.20	9.91	1.79	7.30
	甬矽电子	0.76	0.78	1.19	0.78
	通富微电	0.95	0.91	0.94	0.96
	颀邦科技	2.19	4.09	2.45	1.99
	南茂科技	2.29	2.73	3.42	2.90
	平均值	3.06	4.42	2.58	3.30
	颀中科技	3.41	3.30	3.06	1.76
速动比率 (倍)	晶方科技	4.79	7.84	5.46	5.64
	汇成股份	5.94	8.14	1.14	6.02
	甬矽电子	0.68	0.68	1.05	0.64
	通富微电	0.73	0.70	0.70	0.70
	颀邦科技	1.74	3.54	2.10	1.71
	南茂科技	1.97	2.42	3.07	2.39
	平均值	2.64	3.88	2.25	2.85
	颀中科技	2.59	2.65	2.65	1.26

注：同行业可比公司相关指标取自其定期报告或招股说明书。

报告期各期末，公司资产负债率、流动比率、速动比率与同行业可比公司平均值不存在重大差异。报告期内，公司执行较为稳健的财务政策，保持较为安全的财务结构，努力规避财务风险，变现能力与长期偿债能力均相对较强。随着未来募集资金的到位，公司资本结构将进一步优化，抗风险能力将得到增强。

（四）资产周转能力分析

1、资产周转能力指标分析

报告期内，公司的主要资产周转能力指标如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次/年）	9.36	10.61	13.58	10.71
存货周转率（次/年）	2.87	3.07	2.72	2.36

注：2025 年 1-6 月数据已年化处理，下同。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 10.71 次/年、13.58 次/年、10.61 次/年和 9.36 次/年，总体保持稳定，公司主要客户均为行业知名企业，资质良好，回款风险较小。报告期内，公司存货周转率分别为 2.36 次/年、2.72 次/年、3.07 次/年和 2.87 次/年，随着收入规模的增长，公司存货周转率总体呈上升趋势，存货管理能力良好。

2、与同行业上市公司的比较分析

公司与同行业上市公司的应收账款周转率和存货周转率比较情况如下：

项目	公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周 转率（次/年）	晶方科技	8.45	10.11	10.26	11.96
	汇成股份	6.11	5.93	7.28	6.62
	甬矽电子	5.14	5.72	5.76	6.01
	通富微电	4.60	5.04	5.23	6.23
	颀邦科技	5.14	4.98	4.65	4.43
	南茂科技	4.03	4.20	4.40	4.38
	平均值	5.58	6.00	6.26	6.61
	颀中科技	9.36	10.61	13.58	10.71
存货周转率 （次/年）	晶方科技	7.23	6.51	5.16	4.69
	汇成股份	4.48	4.47	4.11	3.56
	甬矽电子	9.17	8.23	6.07	5.67
	通富微电	6.60	6.27	5.94	6.60
	颀邦科技	6.90	8.52	8.59	10.02
	南茂科技	7.06	7.51	6.16	5.80
	平均值	6.91	6.92	6.01	6.06

项目	公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
	颀中科技	2.87	3.07	2.72	2.36

报告期内，公司应收账款周转率分别为 10.71 次/年、13.58 次/年、10.61 次/年和 9.36 次/年，高于行业平均水平，主要是由于公司应收账款回款情况较好。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.36 次/年、2.72 次/年、3.07 次/年和 2.87 次/年。公司存货周转率低于境内行业平均水平，主要系显示驱动芯片封装测试公司存货中含金原料占比较高，而公司金凸块业务规模相对较大，含金原材料备货量较多，导致期末原材料余额较大，拉低了公司存货周转率。

中国台湾同行业可比公司颀邦科技、南茂科技的存货周转率高于公司，主要系中国大陆与中国台湾会计处理不一致导致收入确认方式不同所致。中国台湾同行业可比公司以完工进度确认收入，确认收入的同时相应结转成本，期末存货主要为原物料。公司系根据客户指令提供加工服务并耗用原材料后，相应的成本计入存货，待实际货物发出后，再根据不同贸易条款所约定的内容，判断主要风险报酬和控制权转移时点并确认收入。收入确认方式的不一致，导致了公司存货周转率与颀邦科技、南茂科技不可比。

综上，报告期内公司应收账款周转率、存货周转率不存在重大异常的情形，收入质量、采购及库存管理水平以及整体经营效率良好。

（五）财务性投资情况

1、财务性投资的认定依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。”

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”是指：

“1、财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

3、上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

4、基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

5、金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

6、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

7、发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

关于类金融业务，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”

2、截至最近一期末，公司财务性投资的情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的会计科目如下：

单位：万元

序号	会计科目	金额	财务性投资金额
1	交易性金融资产	22,942.39	-
2	衍生金融资产	-	-
3	其他应收款	5,349.07	-

序号	会计科目	金额	财务性投资金额
4	其他流动资产	13,031.40	-
5	长期应收款	-	-
6	长期股权投资	-	-
7	其他权益工具投资	-	-
8	其他非流动资产	1,170.91	-
9	其他非流动金融资产	-	-
10	投资性房地产	-	-

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未持有财务性投资，具体分析如下：

（1）交易性金融资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额为 22,942.39 万元，主要系公司为提高资金使用效率，对暂时闲置的资金进行现金管理，购买结构性存款，风险相对较低，不属于财务性投资范畴。

（2）衍生金融资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未持有衍生金融资产。

（3）其他应收款

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 5,349.07 万元，主要系保证金、押金以及根据客户要求代为采购卷带所形成的往来款，不涉及财务性投资。

（4）其他流动资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动资产余额为 13,031.40 万元，主要系增值税进项税留抵和待摊费用，不涉及财务性投资。

（5）长期应收款

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在长期应收款。

（6）长期股权投资

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在长期股权投资。

（7）其他权益工具投资

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在其他权益工具投资。

（8）其他非流动资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产余额为 1,170.91 万元，系公司购置设备预付款项，不涉及财务性投资。

（9）其他非流动金融资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在其他非流动金融资产。

（10）投资性房地产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在投资性房地产。

综上所述，截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

八、盈利能力分析

（一）整体经营情况

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元				
项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	99,576.09	195,937.56	162,934.00	131,706.31
营业成本	72,040.27	134,657.71	104,739.92	79,797.06
营业利润	11,251.02	37,108.13	42,249.35	32,985.53
利润总额	11,274.01	36,902.20	41,866.88	33,778.26
净利润	9,919.14	31,327.70	37,166.25	30,317.50
归属于母公司股东的净利润	9,919.14	31,327.70	37,166.25	30,317.50

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，也是境内最早可提供 8 吋及 12 吋显示驱动芯片全制程封测服务的企业之一。公司持续扩大封装与测试产能，不断提升产品品质及服务质量，加大对新客户开发的同时，持续增加新产品的开发力度，使得公司封装与测试收入保持较快增长。2022 至 2024 年，公司分别实现营业收入 131,706.31 万元、162,934.00 万元和 195,937.56 万元，公司营收规模持续增长。

2024 年度和 2025 年 1-6 月，公司扣非前后归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要是由于：（1）为了吸引和留住优秀人才及核心骨干，公司实施限制性股票激励计划，当期相应摊销的股份支付费用较上年同期有所增长；（2）合肥生产基地项目投产，当期相应的折旧及人工费用等固定成本及费用较上年同期有所增长；（3）在高效散热、高结合力等高性能芯片、车规及高可靠性消费规芯片等先进集成电路封测领域，公司在继续扩充产能的同时持续加大研发投入，当期研发费用较上年同期有所增长。

（二）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	98,102.82	98.52%	191,000.49	97.48%	159,256.80	97.74%	128,764.12	97.77%
其他业务收入	1,473.27	1.48%	4,937.08	2.52%	3,677.20	2.26%	2,942.20	2.23%
合计	99,576.09	100.00%	195,937.56	100.00%	162,934.00	100.00%	131,706.31	100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为 128,764.12 万元、159,256.80 万元、191,000.49 万元和 98,102.82 万元，主营业务收入主要来自显示驱动芯片的封测业务。公司主营业务收入占营业收入的比例均在 97%以上，主营业务突出。

报告期内，公司其他业务收入分别为 2,942.20 万元、3,677.20 万元、4,937.08 万元和 1,473.27 万元，主要为含金废液、光罩等销售产生的收入，占营业收入的比例较低。

2、主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司分业务类型的主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
显示驱动芯片封测	91,695.29	93.47%	175,808.30	92.05%	146,269.68	91.85%	116,748.81	90.67%

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
非显示类芯片封测	6,407.53	6.53%	15,192.18	7.95%	12,987.12	8.15%	12,015.31	9.33%
合计	98,102.82	100.00%	191,000.49	100.00%	159,256.80	100.00%	128,764.12	100.00%

凭借在集成电路先进封测行业多年的耕耘，公司在以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位，目前已形成以显示驱动芯片封测业务为主，非显示类芯片封测业务齐头并进的良好格局。

（1）显示驱动芯片封测业务收入变动分析

报告期内，公司显示驱动芯片封测收入占主营业务收入的比例超过九成。公司显示驱动芯片封测以全制程业务为主，公司会按照产品工艺制程与客户约定价格，并在交付后确认收入。公司建立了以凸块制造（Bumping）为核心，覆盖晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）的全制程服务能力。

报告期内，公司显示驱动芯片封测收入按工艺制程划分的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Bumping	36,989.70	40.34%	68,896.44	39.19%	50,579.82	34.58%	36,861.16	31.57%
CP	18,276.50	19.93%	41,621.50	23.67%	38,897.92	26.59%	33,476.26	28.67%
COG	9,525.78	10.39%	19,679.01	11.19%	14,318.08	9.79%	9,851.63	8.44%
COF	26,824.80	29.25%	45,495.67	25.88%	42,227.93	28.87%	36,270.13	31.07%
其他	78.50	0.09%	115.68	0.07%	245.93	0.17%	289.62	0.25%
合计	91,695.29	100.00%	175,808.30	100.00%	146,269.68	100.00%	116,748.81	100.00%

注：其他系研磨切割业务。

报告期内，公司各工艺制程产品收入均逐年增长。其中，Bumping 收入大幅增长且收入占比逐年提升，主要系：1）金价上涨带动 Bumping 销售单价提升；2）随着客户的需求以及其上游晶圆厂的产能由 8 吋向 12 吋转移，公司 12 吋 Bumping 的销售量迅速增长。同时，受益于显示产业链向中国大陆转移的趋势以及 AMOLED 渗透率的提升，公司 COG 和 COF 的收入逐年上涨，带动公司主营

业务收入持续增长。

(2) 非显示类芯片封测业务收入变动分析

报告期内，公司非显示类芯片封测业务按照产品工艺制程与客户约定价格，并在交付后确认收入。公司现可为客户提供多种凸块制造（Bumping）和晶圆测试服务（CP），也可同时提供后段的 DPS 封装服务。

报告期内，公司非显示业务收入持续增加，由 2022 年的 12,015.31 万元增长至 2024 年的 15,192.18 万元。依托在显示驱动芯片封测领域多年来的积累以及对凸块制造技术深刻的理解，公司不断拓展非显示类芯片客户，积累了昂瑞微、杰华特、唯捷创芯、南芯半导体等众多优质客户资源。公司与行业内大量优质客户长期稳定的合作，为报告期内公司非显示类芯片封测业务的快速增长提供了有力支持。

3、主营业务收入按销售区域划分

报告期内，公司的主营业务收入按销售区域划分情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	66,153.39	67.43%	120,956.26	63.33%	92,554.67	58.12%	69,846.56	54.24%
境外	31,949.43	32.57%	70,044.23	36.67%	66,702.13	41.88%	58,917.56	45.76%
合计	98,102.82	100.00%	191,000.49	100.00%	159,256.80	100.00%	128,764.12	100.00%

报告期内，公司境内收入分别为 69,846.56 万元、92,554.67 万元、120,956.26 万元和 66,153.39 万元，占比分别为 54.24%、58.12%、63.33%和 67.43%，受益于显示产业链向中国大陆不断转移的行业趋势，公司境内销售收入快速增长，境内业务占比迅速提升。

4、主营业务收入季节性分布情况

报告期内，公司主营业务收入的季节性分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	46,535.98	47.44%	43,486.40	22.77%	30,370.69	19.07%	34,120.09	26.50%
第二季度	51,566.84	52.56%	47,742.45	25.00%	36,928.98	23.19%	36,036.51	27.99%
第三季度	-	-	48,507.72	25.40%	44,687.32	28.06%	25,621.59	19.90%
第四季度	-	-	51,263.91	26.84%	47,269.81	29.68%	32,985.93	25.62%
合计	98,102.82	100.00%	191,000.49	100.00%	159,256.80	100.00%	128,764.12	100.00%

报告期内，公司各季度主营业务收入占比受终端需求和生产周期的影响略有波动，但波动幅度较小，主营业务收入总体上无显著的季节性特征。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	71,263.29	98.92%	131,482.63	97.64%	101,857.28	97.25%	77,635.02	97.29%
其他业务成本	776.98	1.08%	3,175.08	2.36%	2,882.64	2.75%	2,162.04	2.71%
合计	72,040.27	100.00%	134,657.71	100.00%	104,739.92	100.00%	79,797.06	100.00%

报告期内，公司主营业务成本分别为 77,635.02 万元、101,857.28 万元、131,482.63 万元和 72,040.27 万元，与主营业务收入增长相匹配。公司营业成本主要由主营业务成本构成，报告期内主营业务成本占比分别为 97.29%、97.25%、97.64%和 98.92%。

2、主营业务成本明细构成

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	20,047.17	28.13%	40,238.96	30.60%	29,288.76	28.75%	22,564.52	29.06%
直接人工	8,889.34	12.47%	16,166.67	12.30%	12,728.09	12.50%	11,551.99	14.88%
制造费用	42,326.78	59.39%	75,077.01	57.10%	59,840.43	58.75%	43,518.51	56.06%
合计	71,263.29	100.00%	131,482.63	100.00%	101,857.28	100.00%	77,635.02	100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要为直接材料、直接人工和制造费用。其中直接材料和制造费用占比超过 85%，是公司主营业务成本的主要组成部分。

报告期内，公司直接材料金额分别为 22,564.52 万元、29,288.76 万元、40,238.96 万元和 20,047.17 万元，占比分别为 29.06%、28.75%、30.60%和 28.13%，主要为金盐、靶材、光刻胶、Tray 盘和散热贴等，其中金盐、靶材是直接材料的主要组成部分。受金价上涨的影响，直接材料在公司 2024 年成本构成中的占比有所提升。

报告期内，公司制造费用金额分别为 43,518.51 万元、59,840.43 万元、75,077.01 万元和 42,326.78 万元，占比分别为 56.06%、58.75%、57.10%和 59.39%。制造费用金额呈上升趋势，主要系公司扩充产能，购置生产设备，折旧金额较高。

3、主营业务成本按产品类别划分情况

报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成如下所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示驱动芯片封测	66,055.41	92.69%	120,726.51	91.82%	92,980.22	91.28%	69,219.42	89.16%
非显示类芯片封测	5,207.88	7.31%	10,756.12	8.18%	8,877.06	8.72%	8,415.60	10.84%
合计	71,263.29	100.00%	131,482.63	100.00%	101,857.28	100.00%	77,635.02	100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要为显示业务产生的成本，显示业务占主营业务成本的比例分别为 89.16%、91.28%、91.82%和 92.69%，与主营业务收入规模相匹配。

(1) 显示驱动芯片封测业务成本变动分析

报告期内，公司显示驱动芯片封测业务成本按工艺制程划分的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Bumping	23,349.79	35.35%	46,430.39	38.46%	34,818.64	37.45%	23,187.35	33.50%
CP	17,027.68	25.78%	29,377.92	24.33%	22,803.26	24.52%	18,012.80	26.02%
COG	7,845.30	11.88%	13,921.91	11.53%	10,183.50	10.95%	7,566.78	10.93%
COF	17,822.24	26.98%	30,981.15	25.66%	25,147.16	27.05%	20,404.55	29.48%
其他	10.40	0.02%	15.14	0.01%	27.66	0.03%	47.94	0.07%
合计	66,055.41	100.00%	120,726.51	100.00%	92,980.22	100.00%	69,219.42	100.00%

注：其他系研磨切割业务。

报告期内，随着公司业务规模持续增长，各工艺制程的成本整体呈上升趋势。2022 年至 2024 年，Bumping 成本占比分别为 33.50%、37.45%和 38.46%，占比较高且占比逐年提升，主要系 Bumping 工序主要原材料为金盐等含金原料，金价逐年上升导致直接材料金额逐年增长，Bumping 成本也随之增加。

（2）非显示类芯片封测业务成本变动分析

报告期内，公司非显示类芯片封测业务成本分别为 8,415.60 万元、8,877.06 万元、10,756.12 万元和 5,207.88 万元，总体呈上升趋势，其中凸块制造成本占比超过六成。各制程成本占比随收入变动有一定的波动，总体上与收入变动趋势一致。

（四）毛利率分析

1、营业毛利构成

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
主营业务毛利	26,839.53	27.36%	59,517.86	31.16%	57,399.52	36.04%	51,129.10	39.71%
其他业务毛利	696.29	47.26%	1,762.00	35.69%	794.56	21.61%	780.16	26.52%
合计	27,535.82	27.65%	61,279.85	31.28%	58,194.08	35.72%	51,909.25	39.41%

报告期内，公司营业毛利金额分别为 51,909.25 万元、58,194.08 万元、61,279.85 万元和 27,535.82 万元，其中主营业务毛利占比在 96%以上。报告期内，公司营业毛利不断提升，主营业务系公司毛利的主要来源。

2、主营业务毛利构成

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示驱动芯片封测	25,639.88	95.53%	55,081.79	92.55%	53,289.46	92.84%	47,529.39	92.96%
非显示类芯片封测	1,199.65	4.47%	4,436.06	7.45%	4,110.06	7.16%	3,599.71	7.04%
合计	26,839.53	100.00%	59,517.86	100.00%	57,399.52	100.00%	51,129.10	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利主要来自显示业务，显示业务毛利金额分别为 47,529.39 万元、53,289.46 万元、55,081.79 万元和 25,639.88 万元，占主营业务毛利比例分别为 92.96%、92.84%、92.55%和 95.53%。

（1）显示驱动芯片封测业务毛利率变化分析

报告期内，公司显示驱动芯片封测业务毛利金额及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
Bumping	13,639.91	36.87%	22,466.04	32.61%	15,761.18	31.16%	13,673.81	37.10%
CP	1,248.82	6.83%	12,243.58	29.42%	16,094.66	41.38%	15,463.46	46.19%
COG	1,680.48	17.64%	5,757.10	29.26%	4,134.57	28.88%	2,284.85	23.19%
COF	9,002.56	33.56%	14,514.52	31.90%	17,080.77	40.45%	15,865.59	43.74%
其他	68.10	86.75%	100.55	86.92%	218.28	88.76%	241.68	83.45%
合计	25,639.88	27.96%	55,081.79	31.33%	53,289.46	36.43%	47,529.39	40.71%

注：其他系研磨切割业务。

1) Bumping（凸块制造）

公司 2023 年及 2024 年凸块制造业务毛利率较 2022 年有所下降，主要系公司为扩充产能，2023 年及 2024 年设备采购规模较大，加之合肥工厂尚在量产初

期，产能利用率正在爬坡，凸块制造单位成本中的折旧金额增幅较大，导致凸块制造毛利率下降。

2025 年 1-6 月，公司凸块制造业务毛利率略有上升，主要系：（1）金价上涨带动金凸块销售单价提升，促进金凸块毛利率同比上升；（2）毛利率相对较高的铜镍金凸块在凸块制造业务收入中占比提升，导致毛利率随之上升。

2) CP（晶圆测试）

报告期内，公司晶圆测试业务毛利率持续下降，主要系晶圆测试销售单价下滑所致。2022 年，下游晶圆测试需求旺盛，公司上调了部分晶圆测试价格，在此轮阶段性行情后，市场需求有所回落，晶圆测试销售单价逐年下降，而设备折旧等成本相对刚性，导致公司晶圆测试毛利率在报告期内持续下降。

2025 年 1-6 月，公司晶圆测试业务毛利率大幅下降，主要系公司集中进行电路板维修及改造，导致制造费用大幅上升，毛利率随之下降。此外，受市场竞争加剧的影响，晶圆测试销售单价有所下降，导致晶圆测试毛利率下滑。

3) COG（玻璃覆晶封装）

2022 年至 2024 年，公司玻璃覆晶封装业务毛利率持续上升。受益于 AMOLED 渗透率的不断提升及显示产业链向中国大陆转移的趋势，公司玻璃覆晶封装销售量在报告期内迅速增长，产销量增长形成的规模效应带动单位固定成本降低，使得公司玻璃覆晶封装毛利率在报告期内持续上升。

2025 年 1-6 月，公司玻璃覆晶封装业务毛利率大幅下降，主要系合肥工厂为导入 COG 客户，销售单价有所下降，同时合肥工厂正处于产能利用率爬坡阶段，尚未形成规模效应，导致单位人工成本及折旧成本较高，毛利率随之降低。

4) COF（薄膜覆晶封装）

2022 年至 2024 年，公司薄膜覆晶封装业务毛利率持续下降。主要系：一方面，受终端高清电视等消费电子需求波动影响，公司薄膜覆晶封装销售单价在报告期内总体呈下降趋势，导致毛利率随之下降；另一方面，随着芯片性能与功耗提升，薄膜覆晶封装中散热贴的用量增加，导致公司薄膜覆晶封装的单位材料成本提升，进一步拉低了毛利率。

2025 年 1-6 月，公司薄膜覆晶封装业务毛利率较上年度保持相对稳定。

(2) 非显示类芯片封测业务毛利率变化分析

报告期内，公司非显示类芯片封测业务毛利率分别为 29.96%、31.65%、29.20%和 18.72%。2022 年至 2024 年毛利率随客户构成和产品结构变化略有波动；2025 年 1-6 月，受终端需求影响，射频芯片封测需求放缓，公司 2025 年 1-6 月非显示类芯片封测业务产能利用率有所下降，单位固定成本上升，导致毛利率下降。

3、与同行业上市公司的对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司毛利率对比情况如下：

可比公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
晶方科技	45.08%	43.28%	38.15%	44.15%
汇成股份	23.53%	21.80%	26.45%	28.72%
甬矽电子	15.61%	17.33%	13.90%	21.91%
通富微电	14.75%	14.84%	11.67%	13.90%
顾邦科技	21.69%	22.46%	25.56%	32.63%
南茂科技	7.96%	12.97%	16.62%	20.89%
平均值	21.44%	22.11%	22.06%	27.03%
顾中科技	27.65%	31.28%	35.72%	39.41%

报告期内，公司毛利率高于行业平均值。受行业整体降价影响，可比公司毛利率总体呈下降趋势，与公司毛利率的变动趋势一致。

同行业可比公司中，晶方科技主要从事 CMOS 影像传感器的封装测试服务，毛利率相对较高；汇成股份凸块制造产能小于公司，规模效应较弱，导致汇成毛利率相对较低；甬矽电子主要从事射频前端芯片和物联网芯片的封装测试服务，毛利率相对较低；通富微电除先进封装业务外，还有较大规模的传统封装业务，毛利率相对较低。

顾邦科技和南茂科技均为中国台湾上市公司，业务范围较广，除凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装等显示驱动芯片封测服务，顾邦科技的主要业务还包括非显示芯片封装与卷带制造，南茂科技的主要业务还包括存储芯片封测和通讯芯片封测，产品结构的差异导致其毛利率相对较低。

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用情况如下表：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	779.09	0.78%	1,479.06	0.75%	1,028.54	0.63%	1,013.58	0.77%
管理费用	6,125.48	6.15%	11,849.02	6.05%	9,975.43	6.12%	7,191.71	5.46%
研发费用	9,231.07	9.27%	15,468.66	7.89%	10,629.43	6.52%	9,991.10	7.59%
财务费用	-436.34	-0.44%	-2,240.66	-1.14%	-2,215.11	-1.36%	1,813.18	1.38%
合计	15,699.30	15.77%	26,556.08	13.55%	19,418.30	11.92%	20,009.57	15.19%

注：上表占比为占同期营业收入的比例。

报告期内，公司的期间费用占营业收入的比例分别为 15.19%、11.92%、13.55%和 15.77%，占比相对稳定。随着公司业务规模不断扩大，销售费用、管理费用、研发费用金额均呈逐年增长趋势，与公司营业收入增长趋势一致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	404.70	942.27	860.42	746.44
股份支付	312.92	383.30	46.42	185.68
业务招待费	15.41	36.77	28.69	16.22
水电费	11.51	25.70	23.87	19.26
差旅费	15.02	22.31	15.46	6.74
折旧与摊销	6.94	14.99	15.38	17.09
其他	12.58	53.71	38.29	22.16
销售费用合计	779.09	1,479.06	1,028.54	1,013.58

报告期内，公司销售费用分别为 1,013.58 万元、1,028.54 万元、1,479.06 万元和 779.09 万元，占各期营业收入的比重分别为 0.77%、0.63%、0.75%和 0.78%，销售费用随收入规模的扩大总体呈上升趋势，占营业收入比重在报告期内基本保持稳定。

公司销售费用主要由职工薪酬和股份支付构成。2022 年至 2024 年，公司销

售费用中职工薪酬分别为 746.44 万元、860.42 万元和 942.27 万元，主要系公司业务规模和订单规模增长，扩充了销售及支持人员数量，职工薪酬相应增长。公司对公司核心员工进行股权激励。报告期各期，公司计入销售费用的股份支付金额分别为 185.68 万元、46.42 万元、383.30 万元和 312.92 万元。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用具体构成情况如下：

单位：万元				
项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	3,061.35	5,932.98	5,915.76	4,439.31
折旧与摊销	690.42	1,926.88	1,159.48	843.86
股份支付	979.72	1,189.27	38.09	122.37
维护与修缮费	332.17	820.95	718.70	555.40
水电燃气费	153.05	336.48	512.45	84.02
中介机构费用	379.59	301.01	259.74	601.07
办公费	66.28	199.48	97.53	83.71
业务招待费	42.76	175.14	273.90	118.21
差旅费	49.93	121.66	120.14	29.00
招聘服务费	68.75	100.81	72.86	73.94
广告宣传费	47.61	83.50	123.64	42.59
交通费	33.74	60.67	63.20	48.45
其他	220.11	600.18	619.95	149.79
管理费用合计	6,125.48	11,849.02	9,975.43	7,191.71

报告期各期，公司管理费用分别为 7,191.71 万元、9,975.43 万元、11,849.02 万元和 6,125.48 万元。报告期内，随着合肥工厂厂房和产线正式启用，公司扩充管理人员以完善管理架构，职工薪酬随之增加。同时，随着合肥工厂正式投入运营，管理费用中折旧与摊销、维护与修缮费、办公费等也在报告期内持续增长。此外，公司对核心员工进行股权激励。报告期各期，公司计入管理费用的股份支付金额分别为 122.37 万元、38.09 万元、1,189.27 万元和 979.72 万元。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	3,933.94	7,593.76	5,575.09	5,238.67
折旧	2,049.67	3,015.78	2,646.90	2,414.16
耗材	1,098.21	2,126.88	1,377.19	1,238.00
股份支付	1,276.04	1,475.41	142.55	245.91
水电费	424.99	734.54	629.74	548.07
其他	448.22	522.28	257.96	306.29
研发费用合计	9,231.07	15,468.66	10,629.43	9,991.10

公司高度重视技术和持续的产品研发创新，报告期各期研发投入持续增加。报告期各期，公司研发费用分别为 9,991.10 万元、10,629.43 万元、15,468.66 万元和 9,231.07 万元，主要由职工薪酬、折旧和耗材构成。此外，公司对核心员工进行股权激励。报告期各期，公司计入研发费用的股份支付金额分别为 245.91 万元、142.55 万元、1,475.41 万元和 1,276.04 万元。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
利息支出	521.73	969.85	2,142.08	4,208.26
减：利息收入	967.09	3,194.98	4,142.71	1,108.81
汇兑损益	-4.06	-41.66	-226.94	-1,308.35
银行手续费	13.08	26.13	12.47	22.08
财务费用合计	-436.34	-2,240.66	-2,215.11	1,813.18

报告期各期，公司财务费用分别为 1,813.18 万元、-2,215.11 万元、-2,240.66 万元和-436.34 万元。公司 2023 年度财务费用较 2022 年度大幅下降，主要系公司 2023 年度偿还了部分银行借款，利息支出随之减少；同时，随着首发上市募集资金到账，公司货币资金余额大幅增加，利息收入随之增加。

（六）其他收益

报告期内，公司其他收益具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
政府补助	136.97	3,359.96	3,196.20	1,780.50
税款手续费返回	21.81	14.43	12.85	9.43
增值税加计抵减额	824.15	1,916.79	1,535.04	-
其他收益合计	982.94	5,291.18	4,744.08	1,789.93

报告期内，公司其他收益分别为 1,789.93 万元、4,744.08 万元、5,291.18 万元和 982.94 万元，主要来源于与日常活动相关的政府补助和增值税加计抵减额。

（七）投资收益

报告期内，公司的投资收益构成明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	534.18	674.57	477.62	486.18
合计	534.18	674.57	477.62	486.18

报告期内，公司投资收益分别为 486.18 万元、477.62 万元、674.57 万元和 534.18 万元，系交易性金融资产持有期间取得的投资收益。

（八）公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
交易性金融资产	42.39	110.07	2.15	7.71
合计	42.39	110.07	2.15	7.71

报告期内，公司公允价值变动收益分别为 7.71 万元、2.15 万元、110.07 万元和 42.39 万元，系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

（九）信用减值损失和资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目		2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
信用减值损失	应收账款坏账损失	-23.69	-16.89	-112.29	106.17
	其他应收款坏账损失	15.39	-22.87	2.16	-47.68
资产减值损失	存货跌价损失	-686.42	-2,106.05	-374.60	-671.54
合计		-694.72	-2,145.81	-484.73	-613.05

报告期内，公司资产减值损失分别为-671.54 万元、-374.60 万元、-2,106.05 万元和-686.42 万元。2024 年资产减值损失金额上升，主要系合肥工厂投资规模较大，量产初期设备折旧金额较高，产能利用率正在爬坡，导致合肥工厂部分库存商品和在产品的可变现净值低于成本，公司对其计提了存货跌价准备。

（十）资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
处置非流动资产的利得	-361.31	100.39	-	-0.09
合计	-361.31	100.39	-	-0.09

报告期各期，公司资产处置收益全部为处置固定资产产生的收益或损失。

（十一）营业外收支

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
政府补助	-	-	280.00	865.10
其他	106.72	43.92	1.05	0.69
合计	106.72	43.92	281.05	865.79

2022 年和 2023 年，营业外收入中政府补助金额分别为 865.10 万元和 280.00 万元，均为与收益相关的政府补助。2025 年 1-6 月，公司营业外收入中其他项目金额为 106.72 万元，主要系取得供应商赔偿款。

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
非流动资产处置损失	73.11	51.15	45.37	3.27
赔偿支出	2.70	191.10	200.47	69.65
滞纳金	7.92	7.24	416.88	0.14
其他	-	0.35	0.80	-
合计	83.73	249.84	663.52	73.06

公司营业外支出主要为赔偿支出和滞纳金。2023 年度公司滞纳金金额较大，主要系公司补缴以前年度企业所得税产生的滞纳金。

（十二）税金及附加分析

报告期内，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
房产税	448.95	841.97	574.49	498.02
城市维护建设税	336.37	397.99	346.43	0.20
教育费附加	144.16	170.57	148.47	0.09
地方教育费附加	96.11	113.71	98.98	0.06
印花税	39.00	74.55	61.48	55.63
土地使用税	17.82	35.64	35.64	29.60
环境保护税	1.11	9.85	0.05	1.24
其他	5.46	1.76	-	-
合计	1,088.98	1,646.03	1,265.55	584.84

报告期内，公司缴纳的税金及附加占营业利润比例较小，对经营业绩影响较小。

九、现金流量分析

报告期内，公司现金流量的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	23,419.10	69,034.67	54,127.52	70,140.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,302.19	-144,717.52	-76,277.82	-48,084.92
筹资活动产生的现金流量净额	-10,922.69	-40,399.78	170,909.57	-14,118.41

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
汇率变动对现金的影响额	-7.09	75.97	263.87	1,452.52
现金及现金等价物净增加额	6,187.14	-116,006.66	149,023.14	9,389.56

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	108,105.72	209,935.32	161,059.00	160,399.20
收到的税费返还	447.52	2,732.50	3,380.34	3,200.88
收到其他与经营活动有关的现金	12,906.57	27,948.49	24,301.44	9,983.56
经营活动现金流入小计	121,459.81	240,616.31	188,740.78	173,583.65
购买商品、接受劳务支付的现金	55,905.17	97,810.72	76,210.22	53,352.38
支付给职工以及为职工支付的现金	25,504.89	39,461.92	31,131.99	30,335.26
支付的各项税费	3,872.83	7,417.06	6,958.50	6,124.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,757.82	26,891.94	20,312.55	13,631.51
经营活动现金流出小计	98,040.71	171,581.65	134,613.26	103,443.27
经营活动产生的现金流量净额	23,419.10	69,034.67	54,127.52	70,140.38

报告期内，公司经营活动现金流入金额分别为 173,583.65 万元、188,740.78 万元、240,616.31 万元和 121,459.81 万元，主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金。报告期内，公司销售回款情况良好，经营活动现金流入持续增长。公司收到其他与经营活动有关的现金分别为 9,983.56 万元、24,301.44 万元、27,948.49 万元和 12,906.57 万元，主要为当期收到的政府补助和代采卷带形成的往来款。

报告期内，公司经营活动现金流出金额分别为 103,443.27 万元、134,613.26 万元、171,581.65 万元和 98,040.71 万元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付的职工薪酬。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
收回投资收到的现金	462,980.57	589,635.55	104,010.00	134,590.00

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
取得投资收益收到的现金	534.18	674.57	485.32	486.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73.93	139.90	-	3.06
收到其他与投资活动有关的现金	-	856.00	-	-
投资活动现金流入小计	463,588.68	591,306.02	104,495.32	135,079.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,713.07	108,341.44	73,532.14	39,405.15
投资支付的现金	434,177.80	626,826.10	107,241.00	143,759.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	856.00	-	-
投资活动现金流出小计	469,890.87	736,023.54	180,773.14	183,164.15
投资活动产生的现金流量净额	-6,302.19	-144,717.52	-76,277.82	-48,084.92

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-48,084.92 万元、-76,277.82 万元、-144,717.52 万元和-6,302.19 万元，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。收回投资收到的现金及投资支付的现金系购买和收回交易性金融资产所产生的现金。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
吸收投资收到的现金	-	-	226,560.00	-
取得借款收到的现金	5,106.40	17,945.38	17,497.85	65,064.72
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,106.40	17,945.38	244,057.85	65,064.72
偿还债务支付的现金	9,445.54	38,666.67	67,003.80	73,431.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,431.79	19,297.72	3,016.72	5,046.27
支付其他与筹资活动有关的现金	151.76	380.77	3,127.75	705.17
筹资活动现金流出小计	16,029.09	58,345.16	73,148.28	79,183.13
筹资活动产生的现金流量净额	-10,922.69	-40,399.78	170,909.57	-14,118.41

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-14,118.41 万元、170,909.57 万元、-40,399.78 万元和-10,922.69 万元。2023 年度公司吸收投资收到的现金 226,560.00 万元，主要为公司首次公开发行并上市募集资金。

十、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司资本性支出紧密围绕主营业务进行，主要用于厂房建设、采购机器设备等。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 39,405.15 万元、73,532.14 万元、108,341.44 万元和 35,713.07 万元。

（二）未来重大资本性支出计划及资金需求量

公司未来重大资本性支出主要是本次募集资金投资项目支出。具体内容详见募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。除本次募投项目外，公司其他未来可预见的资本性支出包括已签订单尚未支付设备工程等采购款项及苏州顾中“三期地块工程建设项目”建设投入。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

报告期内，公司资本性支出均围绕主营业务进行，通过持续的资本性支出投入，公司的产品产能得到提升、产品种类得以丰富、研发创新能力和运营管理能力得以提升，为公司的持续发展经营奠定了基础。

本次募投项目聚焦公司集成电路高端先进封装测试主营业务，通过引入先进的封测设备、导入新的封测制程，进一步提高集成电路先进封装测试全制程生产能力，提升产品的品质和管理效率，增强公司产品的市场竞争能力，满足公司研发布局与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。本次募投项目系公司现有业务的延伸和拓展，所属领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板的行业范围。本次募投项目服务于科技创新领域，符合国家战略方向和行业发展趋势。

十一、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司核心技术先进性及具体体现参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、公司主要技术与研发情况”之“（三）公司核心技术来源及其对发行人的影响”部分。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司正在从事的研发项目如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高密度多引脚多层电镀凸块应用于显示驱动芯片的研究	样品测试阶段	单芯片凸块共面性 2um 内；凸点各层结合力大 5.0g/mil ² ；凸点表面硬度 90±20Hv；凸点表面粗糙度 Tir<1.8um	境内领先水平	应用于显示驱动 IC 封装
2	大尺寸高性能高稳定性射频芯片的研究	样品测试阶段	(1) 凸块高度共面性≤4um； (2) 凸块与 PI 的结合力≥5g/mil	行业领先水平	用于现代物流、供应链管理、电子标签等无线射频识别领域
3	高精密覆晶方形扁平无引脚及模块之封测的技术研究	投产阶段	OS 良率<2000PPM，产品信赖性达 MSL1,condition B	行业领先水平	应用于各类高精密覆晶无引脚芯片及模块的先进封装
4	车规级高稳定性铜柱芯片封装的研究	样品试产阶段	建立 1P1M 以上结构的车载芯片,铜柱工艺可提供 CuSn、CuNiSn 等不同金属类别；铜柱高度公差达到业界领先水平	行业领先水平	用于高阶芯片封装,例如车载充电器,车载无线充电、信息娱乐系统等车载电子功能芯片
5	应用于车载高性能显示芯片金凸块生产的研究	工艺开发验证阶段	凸块高度共面性≤4um；凸块结合力大于 8mg/um ² ；芯片制程良率 99%以上	境内领先水平	应用于高性能、高可靠性的车载驱动芯片
6	多芯片集成薄膜覆晶封装技术的研究	评估开案阶段	(1)多芯片集成封装能力的内引脚接合机达成 2 颗或以上多芯片集成内引脚封装的技术制程能力(2)达成多芯片薄膜覆晶封装封胶技术的能力(3)多芯片薄膜覆晶封装镭射技术的能力	境内领先水平	应用于移动显示装置的应用场景和装置性能
7	晶圆级超高频激光切割技术的研究	评估开案阶段	(1)超高频激光切割技术及其工艺参数,使 Debris≤5um,槽底 TTv≤4um (2)通过超高频激光切割 Die strength 要达到 500Mpa 以上	行业领先水平	应用于显示驱动 IC 封装
8	高刷新率及高分辨率显示驱动芯片的测试研究	评估开案阶段	(1)建立完善的显示驱动芯片的测试流程和技术管理体系,提高测试效率和准确性。(2)完成 ATE Tester 高速 MIPI 板卡性能及数量升级,确保超高速 IO 信号输出稳定性,同时保证最大的同测 site 数,以提高驱动芯片的测试效率(3)优化测试数据的分析工具,可以实现测试数据的自动导出与分析,针对关键测试项目 Item 进行自动分析处理,最终提升芯片的整	行业领先水平	主要应用于高刷新率及高分辨率显示驱动芯片领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
			体测试效率		
9	晶圆减薄与背面金属的研究	工艺开发验证阶段	1.正面金属化（FSM）加工良率大于 99.8%;2.金属化工艺技术涵盖蒸镀与溅镀;3.晶圆减薄厚度最低可达 40um	境内领先水平	应用于车用电子、工业电子等高阶功率器件芯片
10	大尺寸高结合力金凸点的研究	样品测试阶段	整片晶圆金凸点的侧蚀 $\leq 1\mu\text{m}$ 晶圆特性值水准满足客户规格	行业领先水平	用于显示驱动芯片
11	应用于晶圆级显示驱动芯片同测数的研究	评估开案阶段	研究驱动芯片同测数，提升测试效率，降低测试成本	行业领先水平	用于显示驱动芯片
12	高抗弯折显示驱动芯片封装研究	样品试产阶段	改善产品应力，增强芯片抗弯折能力 Die strength $\geq 500\text{Mpa}$	行业领先水平	用于高阶显示芯片封装，如柔性折叠屏等
13	薄膜覆晶封装高效散热技术的研究	样品试产阶段	提高热量传导效率，降低芯片热量，延长产品使用寿命	行业领先水平	应用于高清，高频显示驱动芯片，如大尺寸高清电视，电竞屏等
14	大尺寸多层电镀凸块应用于显示驱动芯片的研究	工艺开发验证阶段	凸块尺寸稳定在目标 $\pm 3\mu\text{m}$; 凸块硬度稳定在目标 $\pm 15\text{Hv}$; 凸块高度稳定在 $\pm 3\mu\text{m}$; 凸块表面粗糙度稳定在 $< 2\mu\text{m}$; 凸块切应力稳定在 $> 5\text{g/mil}^2$; 整片晶圆凸块高度均匀度稳定在 $< 3\mu\text{m}$; 单个芯片凸块高度均匀度稳定在 $< 1\mu\text{m}$	行业领先水平	主要应用于显示驱动芯片领域

（三）保持持续技术创新的机制和安排

集成电路先进封装与测试本质上属于制造行业，需要针对所封测芯片的变化进行不断的技术优化和创新，以提高产品的稳定性、可靠性，从而更好发挥芯片的效能。公司将技术革新作为实现可持续发展的核心动力，构建了以研发中心为主的研发组织架构，覆盖集成电路凸块制造、封装、测试等主要环节的全链条研发体系。为保证公司继续在集成电路封测细分行业内的领先地位，公司时刻紧随市场及行业趋势，采取了一系列的技术创新措施保证自身的核心竞争力，具体参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”之“（二）保持科技创新能力的机制或措施”。

十二、重大担保、诉讼或仲裁、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响

截至募集说明书签署日，公司不存在重大对外担保、诉讼、或有事项或其他

重大期后事项。

十三、本次发行对发行人的影响情况

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行完成后，本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。本次发行有利于进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的行业领先地位，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

本次发行完成后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到提升，为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债大部分转换为公司股票，公司的净资产将有所增加，资本结构将得到改善。

（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。因此，本次募投项目与现有业务密切相关，上市公司不存在本次发行完成后新旧产业融合情况发生重大变化的情况。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司的实际控制人仍为合肥市国资委，公司控制权不会发生变化。

第五节 本次募集资金运用

一、本次发行募集资金使用计划

（一）本次募集资金投资项目概况

本次发行的募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	41,945.30	41,900.00
2	硕中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	43,166.12	43,100.00
合计		85,111.42	85,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（二）本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。凭借在集成电路先进封装行业多年的耕耘，公司在以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位，形成了以显示驱动芯片封测业务为主，电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封测业务齐头并进的良好格局。

公司本次募集资金投资项目是基于现有主营业务基础上，按照业务规模发展情况和技术研发创新的要求对现有业务进行扩张和提升，满足公司在高端先进封

装行业进一步提高技术研发实力的需要。项目完成后，公司的生产能力和市场竞争力将得到大幅提升，能够有效支撑公司长期可持续发展，有利于提升公司核心竞争力。

二、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

（一）高脚数微尺寸凸块封装及测试项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为合肥颀中科技股份有限公司，建设地点位于安徽省合肥市，项目建设期为 24 个月。本项目拟通过对合肥现有厂房进行改造，通过建造新的洁净车间、引进新的先进生产线，进一步扩充显示驱动芯片封装测试整体产能，完善铜镍金 Bumping 工艺布局，满足应用市场对显示驱动芯片封测的最新需求，整体提升公司在相关产品方面的竞争力。

2、项目必要性分析

（1）抓住市场增长机会，扩大显示芯片封装产能

显示芯片封测行业正迎来重要发展机遇。2024 年全球显示驱动芯片封测市场规模同比增长 6.0%，其中中国大陆市场规模达 76.5 亿元，同比增长 7.0%，增速高于全球水平。预计到 2028 年全球市场规模将达到 32.4 亿美元，中国大陆市场将保持 4%以上的稳定增长。

市场需求增长主要来自三个方面：首先是智能手机、平板电脑等消费电子的持续升级。根据赛迪统计，智能手机在显示面板下游终端出货量中占比最大，超过 50%。特别是 AMOLED 渗透率的持续提升，带动了对高性能显示驱动芯片的需求。其次是大尺寸显示市场的结构性变化，预计到 2026 年，65 英寸及以上的面板占比将达 38.65%，超高清户外大屏出货量也有明显增长。随着分辨率的提升，单台设备所需的显示驱动芯片数量显著增加，如 4K 电视需要 10-12 颗显示驱动芯片，8K 电视更是高达 20 颗。第三是新兴应用领域的快速扩张。车载显示、智能穿戴、虚拟现实等新兴领域对显示技术提出了更高要求，不仅需要更高的分辨率和刷新率，还需要更灵活的显示形态，这些都为显示驱动芯片封测带来新的市场机会。

为抓住市场机遇，巩固行业地位，公司拟通过本项目新增铜镍金 Bumping、CP、COG、COF 等关键工艺的生产能力，显著提升公司在显示驱动芯片封测领域的市场竞争力。

（2）技术创新与成本优化并重，提升市场竞争力

显示驱动芯片封测行业正面临重要的技术发展机遇。金凸块作为主流封装材料，在电性能、可靠性和工艺成熟度方面具备显著优势，是高端显示驱动芯片封装的重要技术选择。但随着下游应用市场的不断扩大，特别是在消费电子领域，市场对更具性价比的封装解决方案需求日益增长。铜镍金（CuNiAu）凸块技术通过在铜基底上镀覆镍层和薄金层的结构设计，在满足此类市场需求的同时实现了成本的有效控制，为显示驱动芯片封装提供了新的技术选择。

从技术布局来看，发展多元化的封装技术路线，能够更好地满足不同细分市场的需求。金凸块技术将继续发挥其性能优势，而铜镍金凸块技术则可以满足对成本更为敏感的应用领域需求。这种差异化的技术布局有助于企业更好地服务不同类型的客户，扩大市场覆盖范围。

本项目将布局铜镍金凸块工艺产线，形成多元化的技术服务能力。通过优化产品结构和成本结构，增强公司在不同细分市场的竞争优势。通过全面的技术布局将帮助公司把握市场机遇，为未来持续发展奠定坚实基础。

（3）把握产业转移机遇，强化本土配套能力

显示产业正加速向中国大陆转移，带动了产业链本土化配套需求的快速增长。2024 年中国大陆 LCD 面板产能达 2.16 亿平方米，全球占比达 72.7%；AMOLED 面板产能达 1,607 万平方米，全球占比达到 38.0%，且预计 2028 年将提升至 44.4%。随着中国面板产业的快速发展和产能的持续扩张，上游显示驱动芯片封测的本土化配套需求日益迫切。

产业转移带来的市场机遇主要体现在三个方面：首先，中国大陆面板厂商在全球的市场份额持续提升，带动了对本土配套的需求。其次，国际贸易环境的变化推动了产业链的重构，促使更多国际客户寻求中国大陆的封测产能。第三，国家持续加大对集成电路产业的支持力度，为行业发展创造了有利环境。在此背景下，国内显示驱动芯片封测企业迎来了难得的发展机遇。

本项目通过扩大显示驱动芯片封测产能，将帮助公司更好地把握产业转移机遇。一方面可以更好地满足快速增长的国内市场需求，为中国大陆面板产业提供更好的配套服务；另一方面通过引进先进工艺设备并持续提升技术能力，进一步增强在显示芯片封装领域的自主可控能力，降低对境外产能的依赖程度，提升供应链的稳定性和韧性。这不仅有利于公司的可持续发展，也将为国内显示产业链的完善提供重要支撑。

（4）优化生产效率，降低成本并提升核心竞争力

随着显示芯片封装市场的快速发展，生产效率的提升已成为行业领先企业保持竞争优势的重要因素，提升生产效率、优化资源配置已成为公司扩展产能、提升竞争力的关键。

通过本项目，公司将引入更为先进的自动化生产设备和智能化管理系统。在生产设备方面，将新增先进的高精度封装设备，提升生产的自动化水平，减少人工干预带来的不确定性。在生产管理方面，将通过智能化系统实现生产过程的实时监控和精细化管理，优化生产排程，提高设备利用率。这些升级将帮助公司在保证产品质量的同时，显著提升生产效率，缩短产品交付周期。

此外，自动化和智能化水平的提升还将带来显著的成本优势。通过减少人工成本、提高材料利用率、降低能源消耗等方式，优化公司的成本结构。预计项目实施后，公司的生产效率将获得显著提升，单位产品的生产成本将进一步降低，这将为公司未来的持续盈利和市场扩展奠定坚实基础。

3、项目可行性分析

（1）行业发展趋势和政策支持为本项目提供有利的外部环境

整体来看，显示驱动芯片封测行业发展趋势向好。一方面，下游显示面板产业持续升级，不断涌现出超大尺寸、高刷新率、柔性显示等新技术和新产品，为封测行业带来广阔市场空间。另一方面，显示驱动芯片在 AI、VR/AR、车载显示等新兴领域的应用不断深化，推动了封测技术的持续创新。

在产业政策方面，集成电路产业得到国家持续支持。2020 年 7 月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提到集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，从财

税、投融资、研究开发等八大方面对助力集成电路企业的发展。同时，新型显示产业的发展规划也为显示驱动芯片封测带来机遇。2024 年 1 月发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》明确提出突破 Micro-LED 等显示技术并实现规模化应用。此外，2022 年工信部等五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）》要求推进 4K 以上新型微显示器件的规模量产，开发配套显示驱动芯片。

在区域发展环境方面，合肥作为“集成电路、新型显示、人工智能等三大国家级战新产业集群”，在土地、税收、融资等方面为集成电路企业和新型显示产业链公司提供了优惠政策。同时，当地完善的产业配套体系和丰富的人才资源，也为项目实施创造了良好条件。这些有利的政策环境和区域优势，将有力支持本项目的顺利实施。

（2）深厚的技术积累和持续的创新能力为项目实施提供技术保障

公司深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，形成了以凸块制造、覆晶封装和测试为核心的完整技术体系。在凸块制造环节，公司已成功掌握金凸块和铜镍金凸块两大主流技术路线。在传统金凸块工艺方面，自主研发的“微细间距金凸块高可靠性制造技术”和“大尺寸高平坦化电镀技术”解决了显示驱动芯片高密度 I/O 制造的关键难题，提高了金凸块与芯片的结合力，显著提升了电镀工艺的稳定性。在铜镍金凸块技术领域，公司开发出“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”，为显示驱动芯片封装提供了更具成本优势的解决方案，目前公司是境内少数实现显示驱动芯片铜镍金凸块规模化量产的企业，工艺良率已达到与金凸块相当的水平。

在后段封装环节，公司开发的 COG/COF 封装技术体系针对性解决了显示驱动芯片的技术痛点。“高精度高密度内引脚接合技术”实现了芯片与基板的精准对位，有效提升了封装可靠性；“125mm 大版面覆晶封装技术”则大幅提高了单片基板的封装密度，显著提升了生产效率。公司还开发出“全方位高效能散热解决技术”，有效解决了高性能显示驱动芯片在工作过程中的发热问题。

在测试环节，公司自主开发的“测试核心配件设计技术”和“集成电路测试自动化系统”形成了完整的测试解决方案。这套系统不仅能满足不同客户的个性

化测试需求，还实现了测试过程的高度自动化，大幅提升了测试效率和准确性。

本项目计划新增的 Bumping、CP、COG 和 COF 产能，将依托公司现有的成熟技术体系，特别是在铜镍金凸块方面的技术储备，有效增强公司的市场竞争力。公司完整的技术体系将确保新增产能能够快速达产并保持稳定的良率水平。

(3) 公司丰富的客户资源保障本项目新增产能顺利消化

公司凭借领先的技术实力和稳定的产品质量，在显示驱动芯片封测领域积累了大量优质客户资源。在境外客户方面，公司与联咏科技、奇景光电、瑞鼎科技、敦泰电子、谱瑞科技等国际知名显示驱动芯片设计公司建立了长期稳定的合作关系。这些客户在全球显示驱动芯片市场占据重要地位。在境内客户方面，公司长期服务了集创北方、奕斯伟计算、格科微、云英谷、豪威科技、通锐微等快速成长的本土企业，随着国产化进程加快，这些本土企业的市场份额持续提升。

公司与主要客户的合作关系建立在严格的供应商认证基础上。显示驱动芯片封测供应商的认证周期通常需要 12-18 个月，认证内容涵盖技术能力、质量控制、产能规模、交付能力等多个方面。一旦通过认证并开始批量供货，客户基于产品质量稳定性和供应链安全的考虑，通常不会轻易更换供应商。目前公司已通过多家国际知名客户的质量体系认证，并持续获得客户的积极认可。

公司采取“客户优先”的服务战略，建立了专业的客户服务团队。在新产品导入阶段，公司技术团队提前介入客户的产品开发过程，协助客户优化产品设计，缩短产品开发周期。在量产阶段，公司能够根据客户需求快速调整生产计划，确保及时交付。这种深度合作模式显著增强了客户粘性，多家重要客户已与公司建立了战略合作关系，并获得客户广泛赞誉。公司正在积极开发新的客户资源，未来将进一步扩大客户群体，为产能消化提供更广阔的市场空间。

稳定的客户合作关系和良好的市场口碑，丰富的客户资源和持续增长的市场需求，将为本项目新增产能的顺利消化提供有力保障。

(4) 数十年行业积累和稳定的管理团队是项目实施的重要支撑

公司深耕集成电路封装测试行业数十年，在显示驱动芯片封测领域积累了丰富的运营管理经验。通过多年的实践和探索，公司建立了一套完整的生产运营管理体系，涵盖从产品研发、生产制造到品质管控的全流程。特别是在产能扩充项

目管理方面，公司已成功完成多次重大产线建设，积累了丰富的项目实施经验。本项目将延续公司成熟的项目管理模式，确保项目如期达产。

在质量管理体系方面，公司通过了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系等多项国际认证。目前公司在 Bumping、CP、COG/COF 等各主要环节的良率均高于行业平均水平。公司还开发并实施了 MES（制造执行系统）等现代化信息管理系统，实现了生产过程的实时监控和精细化管理，为大规模产能扩充奠定了管理基础。

公司核心管理团队保持高度稳定，多位高管在显示驱动芯片封测领域拥有 15 年以上从业经验。通过实施员工持股计划等长效激励机制，公司建立了一支专业能力突出、执行力强的运营团队。稳定的管理团队和完善的管理体系，将有效保障本项目的顺利实施。

4、项目实施和投资概算

本项目建设总投资 41,945.30 万元，具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建设工程费用	40,345.30	96.19%
1.1	装修工程费用	6,644.00	15.84%
1.2	软硬件购置	33,369.10	79.55%
1.3	预备费用	332.20	0.79%
2	铺底流动资金投入	1,600.00	3.81%
3	项目总投资	41,945.30	100.00%

项目建设期为 24 个月，项目实施进度安排具体如下：

序号	项目	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	装修工程												
2	设备购置												
3	设备安装调试												
4	员工招聘及培训												
5	试生产												
6	正式生产												

5、效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目的营业收入的测算系以公司同类型产品的平均销售单价为基础，结合市场情况及公司的良品率，在谨慎性原则基础上确定，预计项目完全达产后每年将实现销售收入为 35,587.54 万元。

本项目的成本费用包括产品的直接材料、人工成本、制造费用。直接材料参考公司同类型产品的直接材料历史比值及趋势，按照本项目的销售收入的一定比例测算；直接人工成本参考各同类产品的人工成本历史比值及趋势，按照本项目的销售收入的一定比例测算。制造费用主要包括折旧摊销、燃料动力等其他费用。折旧摊销费用中装修工程按照 10 年折旧，机器设备按照不同类别分别按照 10 年、8 年和 5 年折旧，软件按照 3 年摊销；燃料动力费用主要包括水、电，根据同类产品的历史数据与比值及趋势，按照本项目的销售收入的一定比例测算。

增值税按照 13% 测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2% 进行计提；企业所得税率按 25% 测算。

根据测算，本项目建成后，所得税后财务内部收益率为 13.24%，项目静态投资回收期为 6.93 年（税后，含建设期）。

6、项目备案、环评事项及进展情况

截至募集说明书出具之日，本项目已完成项目备案手续（项目代码：2501-340163-04-02-801207）；本项目已取得合肥市生态环境局出具的《关于合肥顾中科技股份有限公司高脚数微尺寸凸块封装及测试项目环境影响报告表审批意见的函》（环建审〔2025〕12017 号）；本项目不涉及新增用地。

（二）顾中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为顾中科技（苏州）有限公司，建设地点位于江苏省苏州市，项目建设期为 21 个月。本项目拟通过在现有的生产车间及办公区域内构建本项目所需的生产、办公等其他生产辅助配套空间，引进、购置一批先进的生产配套设施，提升非显示类芯片的封装测试产能，完善公司非显示类芯片全制程的服务

能力。

2、项目必要性分析

(1) 提升我国集成电路先进封装产业发展质量

近年来，随着我国社会经济稳步提升以及科学技术飞速发展，产业链上游的芯片设计产业凭借其高附加值特性加速成长，有力地推动了下游集成电路封装测试行业的发展。与此同时，中国大陆集成电路制造领域呈现出蓬勃发展的态势，这进一步为下游封测行业的进步注入了强劲动力。据中国半导体行业协会发布的统计数据显示，2024 年中国大陆集成电路封装测试行业的销售规模达到 3,146 亿元，增速为 7.3%，但目前中国大陆传统封装占比相对较高。在集成电路制程不断向更高精度发展的背景下，单位面积 I/O 端口数持续提升，先进封装作为延续和拓展摩尔定律的关键手段，无疑将成为未来集成电路实现高质量发展的重要方向。

本项目旨在完善公司在非显示类芯片封测全制程技术，新增产能全部属于先进封装与测试范畴，该项目的实施将为我国集成电路行业提供更为先进、全面的封装测试服务，助力国内集成电路产业在先进封装领域实现突破，提升整体产业竞争力，推动行业向高端化迈进，在全球集成电路产业竞争格局中占据更有利的地位。

(2) 完善非显示类芯片封测制程

依托于在显示驱动芯片封测业务多年来的积累，公司于 2015 年进入非显示类芯片封测领域。经过多年的发展，公司非显示类芯片封测业务收入占比总体呈现出上升趋势，2024 年度占比约 8%，但与行业内的头部企业相比，公司非显示类芯片封测业务的总体规模仍然较小。

在制程方面，目前公司非显示类芯片封测业务主要集中于非全制程，业务收入主要来源于凸块制造和晶圆测试环节。反观长电科技、通富微电、华天科技等境内综合类封测企业，它们主要以全制程封测业务为主，相比之下，公司在综合竞争力方面略显不足。

本项目通过引进业内先进设备，在扩充非显示芯片 CP 环节产能的同时，新导入了 BGBM/FSM、Cu Clip 和载板覆晶封装制程，这一系列举措将使公司构建

完善的全制程封测技术体系，提升公司在非显示类芯片封测领域的市场竞争实力，为后续业务的进一步拓展与市场份额的提升奠定坚实基础。

(3) 扩大下游应用领域，扩充公司业务版图

当前，集成电路行业正处于蓬勃发展深刻变革的关键时期。在全球范围内，受益于物联网、人工智能、5G 等新兴科技的迅猛发展，集成电路市场规模持续扩张。在此背景下，非显示业务是公司未来优化产品结构、实现营收增长与推动战略发展的关键着力点。公司凭借在显示驱动芯片封测领域积累的深厚技术优势，积极将业务拓展至其他先进封装领域。始终秉持专注细分领域的核心战略，公司大力发展以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测业务，同时本项目将新增功率器件封装布局，拓展新能源等大功率应用领域。

在战略布局上，公司精准锁定特定细分领域，以此为主轴开展业务。这一策略既能有效规避市场的激烈竞争，又能使公司将有限资源高效投入到具有广阔市场前景的先进封测技术研发中。同时，公司持续加大在新材料、新终端应用等方面的研发投入，不断延伸技术产品线，致力于构建全制程的封测服务体系，逐步向价值链高端攀升。

通过上述举措，公司积极扩充业务版图，坚定不移地朝着综合类集成电路先进封装测试企业的目标大步迈进，力求在集成电路产业中占据更为重要的地位，实现可持续的高质量发展。

3、项目可行性分析

(1) 行业发展趋势和政策支持为本项目提供有利的外部环境

集成电路封测行业正迎来重要的发展机遇期。在“后摩尔时代”，先进封装已成为提升芯片性能的关键途径。根据赛迪统计，2024 年全球先进封装测试业市场规模占整体的比例达 44.9%，未来随着传统芯片制程缩小面临物理极限，先进封装技术成为提升芯片整体性能和功能的重要选择，市场规模占比将继续增加。

在政策层面，国家持续加大对集成电路产业的支持力度。2020 年 7 月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提到集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，从财税、投融资、研究开发等八大方面对助力集成电路企业的发展。各地方政府

也相继出台配套政策，江苏省发布《江苏省人民政府关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》，在产业创新方面提供专项资金支持、政府采购支持、现金奖励支持等；在产业链整体水平方面提供培育招引产业链领航企业、省级专项资金重点支持、数字化转型支持等；在财税金融方面提供财政资金支持、税收优惠、信贷投放支持、融资担保等；在人才引进方面提供高层次人才引进、高校学科专业建设、紧缺人才培养等支持；在发展环境方面提供用地保障、产业供应链顺畅、长三角协同创新、营造良好营商环境等支持。

（2）公司先进封装技术成熟，为项目实施奠定坚实基础

通过多年的积累，公司在集成电路先进封装领域取得了多项核心技术，具有丰富的技术储备。在非显示类芯片封测领域，公司围绕铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等领域开发出“低应力凸块下金属层技术”、“微间距线圈环绕凸块制造技术”、“高厚度光阻涂布技术”、“真空落球技术”等多项核心技术。具体而言，作为大陆地区少数实现铜镍金凸块量产的企业，公司可通过多层金属与介电材质的堆叠，在不改变芯片内部结构的情况下，优化后段封装形式，大幅提升芯片产品性能；在铜柱凸块、锡凸块技术上，公司也实现了较多的技术积累，实现了从凸块制造到后段封装的全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装（Fan-in WLCSP）技术，并已成功导入客户实现量产。该技术可实现封装后芯片尺寸基本等同于封装前尺寸，并降低封装成本，是未来先进封装的主流形式之一。

在测试环节，公司自主开发的“测试核心配件设计技术”和“集成电路测试自动化系统”形成了完整的测试解决方案。这套系统不仅能满足不同客户的个性化测试需求，还实现了测试过程的高度自动化，大幅提升了测试效率和准确性。

在封装环节，针对非显示类芯片的 DPS 封装工艺，公司研发出“高精高稳定性新型半导体材料晶圆切割技术”，在可切割晶圆的精度、厚度、材质等方面进行了创新。针对载板覆晶封装工艺，公司研发出“高精密覆晶方形扁平无引脚及模块之封测的技术”，可以实现大尺寸基板的量产制造，提高了材料效率和生产效率。

以上的技术储备与本项目的定位高度契合。项目新增的 BGBM/FSM、Cu Clip、载板覆晶封装制程将依托现有非显示类芯片封测技术和工艺积累，完善公司全制

程封测技术。公司成熟的技术工艺和研发积累为本项目的顺利实施提供坚实基础。

(3) 下游客户的积极认可为本项目新增产品提供销售保证

公司凭借领先的技术实力和稳定的产品质量，在非显示类芯片封测领域积累了大量优质客户资源。在客户方面，公司与矽力杰、杰华特、南芯半导体、艾为电子、唯捷创芯、希荻微等国内知名非显示类芯片设计公司建立了长期稳定的合作关系。

公司采取“客户优先”的服务战略，建立了专业的客户服务团队。在新产品导入阶段，公司技术团队提前介入客户的产品开发过程，协助客户优化产品设计，缩短产品开发周期。在量产阶段，公司能够根据客户需求快速调整生产计划，确保及时交付。这种深度合作模式显著增强了客户粘性，多家重要客户已与公司建立了战略合作关系，并获得客户广泛赞誉。公司正在积极开发新的客户资源，未来将进一步扩大客户群体，为产能消化提供更广阔的市场空间。

丰富的客户资源和持续增长的市场需求，将为本项目新增产能的顺利消化提供有力保障。

4、项目实施和投资概算

本项目建设总投资 43,166.12 万元，具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建设工程费用	41,766.12	96.76%
1.1	装修工程费用	2,255.00	5.22%
1.2	软硬件购置	39,398.37	91.27%
1.3	预备费用	112.75	0.26%
2	铺底流动资金投入	1,400.00	3.24%
3	项目总投资	43,166.12	100.00%

项目建设期为 21 个月，项目实施进度安排具体如下：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	装修工程								
2	设备购置								

3	产线安装调试								
4	员工招聘及培训								
5	试生产								
6	正式生产								

5、效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司预计同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出。预计项目完全达产后每年将实现销售收入为 34,583.81 万元。

本项目的成本费用包括产品的直接材料、人工成本、制造费用。直接材料参考公司同类型产品的直接材料历史比值及趋势，按照本项目的销售收入的一定比例测算；直接人工成本参考各同类产品的人工成本历史比值及趋势，按照本项目的销售收入的一定比例测算。制造费用主要包括折旧摊销、燃料动力等其他费用。折旧摊销费用中装修工程按照 10 年折旧，机器设备按照不同类别分别按照 10 年和 5 年折旧，软件按照 3 年摊销；燃料动力费用主要包括水、电，根据同类产品的历史数据与比值及趋势，按照本项目的销售收入的一定比例测算。

增值税按照 13% 测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2% 进行计提；企业所得税率按 15% 测算。

根据测算，本项目建成后，所得税后财务内部收益率为 12.06%，项目静态投资回收期为 7.14 年（税后，含建设期）。

6、项目备案、环评事项及进展情况

截至募集说明书出具之日，本项目已完成项目备案手续（备案证号：苏园行审技备〔2025〕109 号）；本项目已取得苏州工业园区生态环境局出具的《苏州工业园区建设项目环保审批意见》（审批文号 20250045、20240064、20240001）；本项目不涉及新增用地。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司所在集成电路封装测试行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，建设自主可控的集成电路产业体系是我国推进战略性新兴产业规模化发展的重点任务之一。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司主要封装技术属于“1.3 电子核心产业”之“1.3.1 集成电路”中的“集成电路芯片封装，采用 SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、FlipChip、TSV 等技术的集成电路封装”，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”。公司作为集成电路高端先进封装测试服务商，主营业务属于科技创新领域。

本次募投项目聚焦公司集成电路高端先进封装测试主营业务，通过引入先进的封装设备、导入新的封装制程，进一步提高集成电路先进封装测试全制程生产能力，提升产品的品质和管理效率，增强公司产品的市场竞争能力，满足公司研发布局与业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。

（二）本次募投项目促进公司科技创新水平提升

集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，随着终端市场的快速发展和行业技术的迭代革新，需持续提升技术水平、丰富产品布局以持续保持竞争优势。公司通过持续稳定的研发投入，积累了深厚的技术及人才储备，掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量工艺经验。通过本次募投项目的实施，公司可以进一步巩固市场地位，强化在全流程封测的技术突破和产业布局，拓宽公司产品下游应用市场，为公司的可持续发展提供保障。

四、本次募集资金对发行人经营和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略布局，具有良好的市场发展前景和经济效益，可以提升

公司市场地位和综合竞争力,实现公司的长期可持续发展,维护股东的长远利益。高脚数微尺寸凸块封装及测试项目将进一步补充公司显示类芯片封测业务产能,发展多元化的封装技术路线,显著提升公司在显示类芯片封测领域的市场竞争力;先进功率及倒装芯片封测技术改造项目将助力公司完善全制程封测技术体系,提升了公司在非显示类芯片封测领域的市场竞争实力。

本次发行完成后,公司的主营业务范围不会发生重大变化。公司仍将具有较为完善的法人治理结构,保持自身各方面的完整性,保持与公司控股股东及其关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、高级管理人员均不存在实质性影响。

(二) 对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后,公司的总资产将相应增加,资金实力将有所提升,公司抗风险能力将得到增强。可转换公司债券转股前,公司使用本次募集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股,公司资产负债率将逐步降低,有利于优化公司资本结构,提升公司的抗风险能力。

本次募集资金投资项目预计具有良好的经济效益,虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降,但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益,公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升,进一步增强公司综合实力,促进公司持续健康发展,为公司股东贡献回报。

第六节 备查文件

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- 二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、法律意见书和律师工作报告；
- 四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- 五、资信评级报告；
- 六、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）

合肥颀中科技股份有限公司



2025 年 10 月 30 日